

关于通富微电子股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票并上市
之

补充法律意见书

(二)

大成证字[2026]第 14-3 号

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)
16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所
关于通富微电子股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票并上市之
补充法律意见书
(二)

大成证字[2026]第 14-3 号

致：通富微电子股份有限公司

本所接受发行人委托，根据本所与发行人签订的关于聘请专项法律顾问的相关协议，担任发行人 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的特聘专项法律顾问。

本所已于 2026 年 2 月 10 日出具了《关于通富微电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并上市之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）和《关于通富微电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并上市之律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）。于 2026 年 3 月 31 日根据深圳证券交易所“审核函〔2026〕120015 号”《关于通富微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》之要求出具《关于通富微电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“补充法律意见书（一）”）、《关于通富微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的专项核查意见》（以下简称“核查意见”）。

现根据发行人自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日（以下称“补充事项期间”）以及截至本补充法律意见书出具之日发生的重大事项及重大变化，在对发行人相关情况进行补充核查验证的基础上，出具《通富微电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并上市之补充法律意见书（二）》（以下简称

“本补充法律意见书”）。

本补充法律意见书是对法律意见书、律师工作报告的补充和修改，并构成法律意见书、律师工作报告不可分割的一部分。除本补充法律意见书另行说明之外，本所在法律意见书、律师工作报告中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于法律意见书已表述过的内容，本补充法律意见书不再重复说明。特别说明，本补充法律意见书中“近三年”或“报告期”指 2023 年、2024 年、2025 年；“《审计报告》”指致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2024）第 110A009718 号”“致同审字（2025）第 110A008881 号”及“致同审字（2026）第 110A012170 号”《审计报告》。除非文义另有所指，本补充法律意见书中所使用简称的含义与法律意见书、律师工作报告所使用简称的含义相同。

对本补充法律意见书，本所律师作出如下声明：

（一）发行人已向本所保证，其所提供的资料文件和对有关事实的口头及书面说明均为真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（二）本所律师依据本补充法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

（三）对本补充法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关行政机关、司法机关、发行人或其他有关单位出具的证明文件和有关说明。本所律师对以上无其他证据可供佐证的证明文件和有关说明视为真实无误。

（四）本所律师仅就与本次向特定对象发行有关之事项发表法律意见，并不涉及有关审计、评估等非本所律师专业事项。本所律师在本补充法律意见书中对

审计结论、财务会计数据、评估结论及依据的引用，并不意味着本所律师对该等内容的真实性及准确性作出任何明示或默示的保证。

（五）本所律师承诺，本所律师已对发行人的行为以及本次向特定对象发行申请的合法合规性进行了充分的核查验证，并已对本次向特定对象发行股票之申请文件进行了审慎审阅。本所律师保证在本补充法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则，本所律师愿意承担相应的法律责任。

（六）本所律师同意发行人按深圳证券交易所的审核要求，在其本次向特定对象发行股票之申请文件中部分或全部引用本补充法律意见书的意见及结论，但该引述不应采取任何可能导致对本所律师意见的理解出现偏差的方式进行。

（七）本补充法律意见书仅供本次向特定对象发行之目的使用，未经本所及本所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本法律意见书用作任何其他目的。本所及本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次向特定对象发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对其承担相应的法律责任。

本所律师依据国家有关法律法规、规范性文件和中国证监会的有关规定，在对发行人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证的基础上，现就发行人本次向特定对象发行股票的条件和行为发表如下法律意见：

目录

一、本次向特定对象发行的授权和批准.....	5
二、发行人的主体资格.....	7
三、发行人本次向特定对象发行的实质条件.....	7
四、发行人的设立.....	8
五、发行人的独立性.....	9
六、发行人的主要股东和实际控制人.....	9
七、发行人的股本及演变.....	11
八、发行人的业务.....	12
九、关联交易及同业竞争.....	14
十、发行人及其合并报表范围内子公司的主要财产.....	17
十一、发行人及其合并报表范围内子公司的重大债权债务.....	29
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	38
十三、发行人章程的制定与修改.....	39
十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会、专门委员会议事规则及规范运作.....	39
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	41
十六、发行人及其合并报表范围内子公司的税务.....	41
十七、环境保护、产品质量和技术监督.....	45
十八、发行人的劳动人事及社会保障.....	46
十九、发行人募集资金的运用.....	48
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....	49
二十一、上市公司向特定对象发行证券审核关注要点落实情况.....	50
二十二、对补充法律意见书（一）相关事项的更新.....	57
二十三、总体结论.....	88

一、本次向特定对象发行的授权和批准

发行人于 2026 年 1 月 9 日召开第八届董事会第十六次会议，于 2026 年 1 月 26 日召开了 2026 年第一次临时股东会现场会议，审议通过了本次发行的相关议案。发行人于 2026 年 4 月 9 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等本次发行方案调整的相关议案。根据前述议案及相关公告，本次发行方案调整如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 440,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入
1	存储芯片封测产能提升项目	88,837.47	80,000.00
2	汽车等新兴应用领域封测产能提升项目	109,955.80	105,500.00
3	晶圆级封测产能提升项目	74,330.26	69,500.00
4	高性能计算及通信领域封测产能提升项目	72,430.77	62,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	123,000.00	123,000.00
合计		468,554.30	440,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

调整后：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 422,000 万元（含本数），

扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入
1	存储芯片封测产能提升项目	88,837.47	80,000.00
2	汽车等新兴应用领域封测产能提升项目	109,955.80	105,500.00
3	晶圆级封测产能提升项目	74,330.26	69,500.00
4	高性能计算及通信领域封测产能提升项目	72,430.77	62,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	105,000.00	105,000.00
合计		450,554.30	422,000.00

注：本次调减公司自发行董事会决议日（第八届董事会第十六次会议决议日，即2026年1月9日）前六个月至今实施或拟实施的财务性投资18,000.00万元，拟使用募集资金投入由原方案中的440,000.00万元调整至422,000.00万元，其中补充流动资金及偿还银行贷款金额由原方案中的123,000.00万元调整至105,000.00万元。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

本议案已经第八届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

根据2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

综上，经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，本次发行及上述调整已经获得发行人内部必要的批准和授权，相关批准和授权仍在有效期内。发

行人本次发行尚需取得深交所审核通过并报中国证监会同意注册。

二、发行人的主体资格

经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人仍系依法设立并经核准公开发行股票上市公司，不存在根据法律法规以及《公司章程》规定需要暂停、终止上市或解散的情形，具备本次发行的主体资格。

三、发行人本次向特定对象发行的实质条件

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人总股本为 151,759.6912 万股，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人控股股东华达集团的持股比例为 19.79%；石明达持有华达集团 39.09%的股权，其子石磊持有华达集团 3.95%的股权，石明达可以控制或影响华达集团共计 43.04%的股权，为华达集团的控股股东，是发行人的实际控制人。本次发行数量在经深交所审核并报证监会注册后，发行人董事会或董事会授权人士与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商）将根据实际认购情况依法确定发行数量和投资者，本次向特定对象发行不存在公司控制权变更风险，符合《管理办法》第八十七条的规定。

根据发行人书面确认并经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人不存在《管理办法》第十一条所述的下列情形：

- （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
- （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重

组的除外；

（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

经核查，本所律师认为，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人本次向特定对象发行仍满足《证券法》和《公司法》《管理办法》规定的向特定对象发行股票的各项实质条件。

四、发行人的设立

本所律师已在律师工作报告中披露了发行人的设立情况。截至 2025 年 12 月 31 日，该部分无变化。本所律师认为发行人的设立程序、资格、条件及方式均已取得有权部门的批准，符合当时法律法规及规范性文件的规定。发起人协议的内容和形式符合当时有关法律法规和规范性文件的规定，不存在因该发起人协议引致发行人的设立行为存在潜在纠纷的情形。发行人设立过程中的有关资产评估和资本验证事宜均已履行了必要程序，符合当时法律法规和规范性文件的规定。发行人创立大会的召开、表决程序与所议事项符合当时有效的法律法规和其他规范性文件的规定。综上，本所律师认为发行人的设立符合当时的法律法规和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

本所律师已在律师工作报告中论述了发行人的独立性。经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人资产独立完整，人员、财务、机构和业务独立；发行人具有完整的业务体系，具备直接面向市场自主独立经营的能力，在独立性方面不存在严重缺陷。

六、发行人的主要股东和实际控制人

（一）发行人的主要股东

根据中登公司查询的发行人前 200 名股东名册，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人前十大股东如下：

序号	股东名称	股东性质	持股比例 (%)
1	南通华达微电子集团股份有限公司	境内一般法人 (02)	19.79
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人 (01)	6.67
3	香港中央结算有限公司	境外法人 (04)	6.43
4	苏州园丰资本管理有限公司—苏州工业园区产业投资基金 (有限合伙)	基金、理财产品等 (06)	1.89
5	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等 (06)	1.18
6	中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等 (06)	0.96
7	华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	基金、理财产品等 (06)	0.95
8	国泰海通证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等 (06)	0.50
9	中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等 (06)	0.29
10	王金根	境内自然人 (03)	0.25

其中，5%以上股东具体情况如下：

(1) 华达集团，住所为南通市紫琅路 99 号，法定代表人石明达，注册资本 2,000 万元人民币，经营范围为：生产销售半导体分立器件，集成电路电子应用产品；经营本企业自产产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿产品销售；自有房屋租赁，停车场服务（另设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2025 年 12 月 31 日，华达集团直接持有发行人股份 300,344,715 股，占公司总股本的 19.79%。

(2) 国家产业基金，住所地北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室，法定代表人张新，注册资本 9,872,000 万元人民币（截至 2025 年 12 月 31 日），经营范围为：股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。截至 2025 年 12 月 31 日，国家产业基金直接持有发行人股份 101,270,409 股，占公司总股本的 6.67%。

(3) 香港中央结算有限公司，商业登记证号码 12793889，办事处地址 8/F., TWO EXCHANGE SQUARE, 8 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, HONG KONG。

经本所律师核查，补充事项期间，新增一位 5% 以上持股股东，香港中央结算有限公司。

经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，华达集团、国家产业基金、香港中央结算有限公司依法存续，具有法律法规和规范性文件规定担任股份公司股东的资格。

（二）实际控制人

石明达，男，中国国籍，无境外永久居留权。1997年10月起任职于发行人，历任总经理、副董事长、董事长，现任发行人名誉董事长、副董事长。

截至2025年12月31日，石明达直接持有华达集团39.09%的股权，其子石磊持有华达集团3.95%股权；此外，石明达直接持有发行人65000股，占发行人总股本的0.0043%；其子石磊直接持有发行人78,000股，占发行人总股本的0.0051%。石明达可以控制或影响华达集团共计43.04%的股权，且华达集团是发行人第一大股东，持有发行人19.79%股份；发行人第二大股东系国家产业基金，已出具不谋求控制权承诺。除发行人第三大股东香港中央结算有限公司外，其余股东持股比例均不及5%，且较为分散。因此，华达集团为发行人控股股东，石明达为发行人实际控制人。

经本所律师核查，发行人的实际控制人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民，具有法律法规和规范性文件规定的担任股份公司股东的资格。

七、发行人的股本及演变

根据发行人股本变动涉及的公告及相关资料及发行人出具的书面说明，补充事项期间，发行人未发生注册资本变更。截至2025年12月31日，发行人前十大股东持股情况详见本补充法律意见书“六、发行人的主要股东和实际控制人”第（一）小节“发行人的主要股东”部分。经本所律师核查，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上查询系统获得的发行人2025年12月31日的《证券质押及司法冻结明细表》，在补充事项期间，华达集团持有的发行人股份质押情况未发生变化。

八、发行人的业务

（一）发行人的经营范围与方式

根据发行人说明并经本所核查，在补充事项期间，发行人的主营业务、经营范围与方式未发生变化。

经发行人确认，并经本所律师核查，发行人经营范围和经营方式符合有关法律法规和规范性文件的规定。

（二）发行人子公司、分公司业务经营

1. 境内子公司

经本所律师核查，合肥城建投资控股有限公司（以下简称合肥城投）作为国家专项建设基金项目的投资平台，以现金共计 6.6 亿元对合肥通富进行投资，投资期限为 10 年，项目建设期届满后，合肥城投以减资或公司回购方式实现投资回收。截至 2025 年 12 月 31 日，合肥通富已偿还合肥城投 6.6 亿元封测产业项目投资款，合肥通富将减少注册资本 6.6 亿元，相关减资手续尚在办理中。截至 2025 年 12 月 31 日，合肥通富工商登记尚未变更。

经本所律师核查，2026 年 3 月 27 日，通富通科的原少数股东南通崇川信创产业投资基金合伙企业（有限合伙）已与发行人签署《股权转让协议》，将其持有的通富通科 13.75% 少数股权全部转让给发行人。2026 年 3 月 30 日，该交易的股权转让对价已完成支付；但截至本补充法律意见书出具日，已完成相关工商变更登记。

经本所律师核查发行人及境内子公司经营范围，并结合相关公司营业执照、审计报告、公开披露的年度报告等对主营业务进行核查，同时结合发行人说明及相关公司的生产经营资质证照对比，本所律师认为，补充事项期间，发行人及合

并报表范围内境内子公司不存在超范围经营情况，且取得了为生产经营所必需的相关证照。

补充事项期间，发行人及其境内子公司生产经营许可及相关资质证照存在以下变更：

序号	获证单位	认可或认证名称	证书编号	发证日期	有效期
1	合肥通富微电子 有限公司	高新技术企业 业证书	GR202534004361	2025 年 12 月 8 日	三年
2	苏州通富超威半 导体有限公司	高新技术企业 业证书	GR202532001726	2025 年 11 月 18 日	三年
3	通富通科（南通） 微电子有限公司	高新技术企业 业证书	GR202532006326	2025 年 12 月 19 日	三年

注：上表中序号 1 合肥通富证照及序号 2 通富超威苏州系到期后续期；序号 3 通富通科系新增证书。

2. 境外子公司

经发行人确认并结合香港律师出具的法律意见书和马来西亚律师出具的法律意见书，在补充事项期间，发行人合并报表范围内境外子公司经营范围与经营方式未发生变化。

（三）发行人业务的变更

根据《审计报告》《营业执照》并经发行人书面确认，发行人近三年主营业务未发生变更。

（四）发行人主营业务是否突出

根据《审计报告》及发行人确认，发行人 2023 年度、2024 年度、2025 年度

的主营业务收入分别为人民币 21,134,845,804.57 元、22,918,526,750.91 元、27,247,567,100.76 元，占上述各期发行人总收入的比例均在 90% 以上。因此，本所律师认为发行人主营业务突出。

（五）发行人业务的持续经营

经本所律师核查及发行人确认，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人在法律、行政法规、国务院决定许可的范围内从事经营活动，依法领有营业执照，不存在依法应当解散或终止的情形。因此，本所律师认为发行人不存在持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）关联方

经本所律师核查，发行人的主要关联方包括：1、控股股东华达集团和实际控制人石明达；2、其他持有发行人5%以上股份的股东：国家产业基金、香港中央结算有限公司；3、控股股东及实际控制人直接或者间接控制的除发行人及其控股子公司以外的法人及其他组织；4、发行人全资及控股子公司和重要参股公司；5、发行人董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员；6、发行人董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织；7、控股股东的董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的，以及担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织；8、报告期内的其他关联方。

经本所律师核查，补充事项期间，发行人的关联方变化如下：

（1）其他持有发行人5%以上股份的股东新增：香港中央结算有限公司（香

港中央结算有限公司系香港交易所全资附属公司，仅为结算机构）；

(2) 重要参股公司企业新增：上海华虹虹芯二期创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领先半导体科技产业股份有限公司；

(3) 重要参股公司减少：滁州广泰半导体产业发展基金（有限合伙），发行人已不再持有该合伙企业的合伙份额；

(4) 发行人董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织新增：科钛芯材（江苏）科技有限公司，陈敏珊于2025年10月16日担任该公司董事。

（二）发行人与关联方之间的重大关联交易

根据《审计报告》并经本所律师核查，发行人2025年与关联方之间发生的重大关联交易如下（单位：万元）：

（1）采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2025年1—12月
北京达博	采购材料	7,969.63
东莞德邦	采购材料	524.68
南通鑫键	危废处理	15.71
厦门通富	委托加工	34,948.25
京隆科技（苏州）有限公司	委托加工	466.76
华进半导体	委托研发	3.60
尚明模具	采购材料	\
德邦科技	采购材料	\

（2）出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2025年1—12月
金茂电子	集成电路封装测试、销售材料	2,428.55
南通尚阳通集成电路有限公司	集成电路封装测试、销售材料	420.92
展讯通信（上海）	集成电路封装测试、销售材料	1,978.30

有限公司		
深圳尚阳通	集成电路封装测试、销售材料	2,947.01
厦门通富	销售材料	32.53
南通鑫键	销售材料	\
华达集团	销售材料	\
厦门紫光展锐 科技有限公司	集成电路封装测试	1,188.68
展讯半导体（南京）有限公司	集成电路封装测试	1,346.30
上海鼎阳通半导体 科技有限公司	集成电路封装测试	1,121.58
西安紫光展锐 科技有限公司	集成电路封装测试	619.05
展讯通信（天津） 有限公司	集成电路封装测试	234.64
展讯半导体（成都）有限公司	集成电路封装测试	180.70
紫光展锐（重庆）科技有限公 司	集成电路封装测试	161.95
紫光展讯通信（惠州）有限公 司	集成电路封装测试	140.33
长鑫集电（北京）存储技术有 限公司	集成电路封装测试	157.37
长鑫新桥存储技术有限公司	集成电路封装测试	138.16
RDA Technologies,Ltd.	集成电路封装测试	34.20

(3) 采购设备

关联方	关联交易内容	2025年1—12月
天津金海通	采购设备、备件	7,248.96
金泰科技	采购设备、备件	4,194.90
北方华创科技集团股份有限公 司	采购设备、备件	3,012.83
南通尚明智能设备制造有限公 司	采购设备、备件	1,225.76
杭州长川科技股份有限公司	采购设备、备件	414.41
深圳华泓	采购设备、备件	31.89
尚明模具	采购模具、备件	29.06
京隆科技（苏州） 有限公司	采购模具、备件	23.36
金茂电子	采购设备、备件	\

(4) 销售设备

关联方	关联交易内容	2025年1—12月
-----	--------	------------

厦门通富	销售设备	379.61
------	------	--------

(5) 向关联方提供其他服务

关联方	关联交易内容	2025年1—12月
厦门通富	厂房租赁及相关服务	3,365.90
南通鑫键	提供公用电、水	283.53
华达集团	提供公用电、水	30.96

(6) 关键管理人员薪酬

项 目	2025年1—12月
关键管理人员薪酬	1,783.51

十、发行人及其合并报表范围内子公司的主要财产

(一) 不动产

1.截至本补充法律意见书出具日，经本所律师核查及发行人书面确认，发行人及其合并报表范围内境内子公司依法拥有的不动产如下：

序号	证书编号	所有权人	面积	使用权类型	用途
1	苏（2017）南通市不动产权第0033325号	发行人	宗地面积110,115.09 m ² 房屋建筑面积 69,141.65m ²	出让/其他	工业用地/ 工业
2	苏（2023）南通市不动产权第0061817号	发行人	宗地面积70,199.00 m ² 房屋建筑面积 23,687.71m ²	出让/自建房	工业用地
3	苏（2017）南通市不动产权第0030635号	发行人	宗地面积10,069.97 m ²	出让	科教用地
4	苏（2023）苏锡通不动产权第0008056号	南通通富	宗地面积135,039.19 m ² 房屋建筑面积 107,116.15m ²	出让/自建房	工业用地
5	苏（2025）苏锡通不动产权第0005689号	南通通富	宗地面积66,454.24 m ² 房屋建筑面积 60,737.82m ²	出让/自建房	工业用地
6	肥西国用（2015）第4418号	合肥通富	使用权面积 132,290.99m ²	出让	工业
7	皖（2023）肥西县不动产权第	合肥通富	房屋建筑面积	自建房	工业

	0026324号		938.67m ²		
8	皖（2023）肥西县不动产权第0026322号	合肥通富	房屋建筑面积2,400m ²	自建房	工业
9	皖（2023）肥西县不动产权第0026319号	合肥通富	房屋建筑面积622.16m ²	自建房	工业
10	皖（2023）肥西县不动产权第0026321号	合肥通富	房屋建筑面积176.46m ²	自建房	工业
11	皖（2023）肥西县不动产权第0026323号	合肥通富	房屋建筑面积37.00m ²	自建房	工业
12	皖（2023）肥西县不动产权第0026320号	合肥通富	房屋建筑面积122.50m ²	自建房	工业
13	皖（2023）肥西县不动产权第0026318号	合肥通富	房屋建筑面积20.72m ²	自建房	工业
14	皖（2023）肥西县不动产权第0026314号	合肥通富	房屋建筑面积168.30m ²	自建房	工业
15	皖（2022）肥西县不动产权第0020729号	合肥通富	房屋建筑面积17,542.15m ²	自建房	工业
16	皖（2022）肥西县不动产权第0020730号	合肥通富	房屋建筑面积14,267.09m ²	自建房	工业
17	皖（2022）肥西县不动产权第0020731号	合肥通富	房屋建筑面积59,066.52m ²	自建房	工业
18	皖（2022）肥西县不动产权第0020732号	合肥通富	房屋建筑面积28,582.20m ²	自建房	工业
19	苏（2024）南通市不动产权第0037459号	通富通达	宗地面积144,792.84m ²	出让	工业用地
20	苏（2025）苏州工业园区不动产权第0000272号	通富苏州	土地面积60,086.70m ² 建筑面积74,912.78m ²	出让	工业用地
21	苏（2026）苏州工业园区不动产权第0000002号	通富超威苏州	土地面积39,482.59m ² 建筑面积85,735.34m ²	出让/自建房	工业用地/ 非居住
22	闽（2023）厦门市不动产权第0022097号	厦门通富	宗地面积87,414.04m ² 建筑面积53,708.65m ²	出让/自建房	工业用地

注：上表中第 21 项苏（2026）苏州工业园区不动产权第 0000002 号不动产权证系律师工作报告第 21 项于 2026 年 1 月 5 日变更后的最新不动产权证，较原不动产权证新增了建筑物面积，其余不动产情况与律师工作报告披露一致。

2、根据马来西亚律师出具的法律意见书，并经发行人及 TF AMD 相关人员确认，补充事项期间，发行人合并报表范围内境外子公司依法拥有的不动产无变化。

（二）在建工程

根据 2025 年度《审计报告》并经发行人确认，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其合并报表范围内子公司在建工程期末余额为 3,116,580,487.20 元。

根据发行人及 TF AMD 相关人员说明并经本所律师核查，补充事项期间，发行人及合并报表范围内子公司 1000 万以上在建工程情况主要合法性文件取得情况如下：

（1）3 楼洁净室和动力安装工程

根据发行人及 TF AMD 相关人员提供的资料，3 楼洁净室和动力安装工程已于 2025 年 9 月 25 日取得 Letter of Award dated 5 September 2025 entered into between Kide International SdnBhd and TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn Bhd；2025 年 12 月 19 日取得 DOSH CONSTRUCTION WORK NOTIFICATION CERTIFICATE。

（2）通富通科集成电路测试中心项目一厂房 3 三层机电安装工程

通富通科集成电路测试中心项目一厂房 3 三层机电安装工程，已于 2025 年 2 月 10 日取得南通市崇川区数据局“崇数据备[2025]52 号”《江苏省投资项目备案证》；2025 年 9 月 30 日取得南通市数据局“320600202509300399 号”《建筑工程施工许可证》；2026 年 3 月 9 日取得南通市住房和城乡建设局“通建消查字[2026]第 0039 号”《其他建设工程消防验收备案复查结果通知书（合格）》。

经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其合并报表范围内子公司新增以上在建工程已依法取得上述证照。

（三）注册商标

经本所律师核查并经发行人确认，补充事项期间，发行人无新增注册商标。

（四）注册商标使用许可

经发行人确认，补充事项期间，发行人注册商标使用许可情况无变化。

（五）专利及非专利技术

1. 专利

（1）结合发行人确认，经本所律师核查相关权利证书，并通过国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询网站 <http://cpquery.cnipa.gov.cn/> 查询，补充事项期间，发行人及其合并报表范围内境内子公司新增下列专利权维持状态的实用新型专利：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	申请人
1	一种手动贴片对位装置	2024229949428	2021/12/5	发行人
2	一种防护装置	2025201424777	2025/1/21	通富超威苏州
3	一种加固片贴装工具	2024229920913	2024/12/5	通富超威苏州
4	一种清洁装置	2024228820918	2021/11/26	通富超威苏州
5	一种用于芯片封装的自动翻转装置	2024232023519	2024/12/24	通富超威苏州
6	一种基板固定治具	2024225800946	2024/10/24	通富超威苏州
7	一种 AGV 运输架	2024226930330	2024/11/6	通富超威苏州
8	一种束带机 tray 盘固定装置	2025201639980	2025/1/24	厦门通富
9	一种滚轮组件及卷带式薄膜覆晶封装装置	2024233022551	2024/12/31	厦门通富

（2）经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，律师工作报告中披露的以下专利已终止失效：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	申请人
1	CPU 不良品在线提取装置	2015210818562	2015/12/23	通富超威苏州
2	CPU 插槽自动清洁装置	2015210818100	2015/12/23	通富超威苏州
3	CPU 测试头温度调节装置	2015210802386	2015/12/23	通富超威苏州
4	CPU 温度测试头短路保护机构	2015210818609	2015/12/23	通富超威苏州
5	制冷机液位监控系统	2015210803196	2015/12/23	通富超威苏州
6	CPU 插槽固定拉杆限位器	2015210818098	2015/12/23	通富超威苏州
7	CPU 测试单元自动送检机构	2015210818577	2015/12/23	通富超威苏州
8	一种去胶装置	2015211415164	2015/12/31	发行人
9	基板传送轨道	2015211337625	2015/12/30	发行人
10	基板传送检测报警装置	201521132375X	2015/12/30	发行人
11	半导体绝缘电阻测量装置	201521128701X	2015/12/29	发行人
12	一种半导体封装治具	2015211117466	2015/12/28	发行人
13	一种基板开短路测试载具	2015211067490	2015/12/25	发行人
14	一种用于测试强度的治具	2015210982590	2015/12/25	发行人
15	预防芯片卷入的助焊剂槽	2015210889962	2015/12/23	发行人
16	一种半导体载体治具	2015210861647	2015/12/23	发行人

序号	专利名称	专利号	专利申请日	申请人
17	一种电器件测量治具	2015210780160	2015/12/21	发行人
18	一种快速检验载曲翘曲的治具	2015210743119	2015/12/21	发行人
19	检验植球质量的装置	2015210707447	2015/12/18	发行人
20	倒装回流焊盖板	2015210717171	2015/12/18	发行人
21	预防顶针不共面的磁性顶针座	2015210652177	2015/12/18	发行人
22	预防薄芯片破损的顶针帽装置	2015210660807	2015/12/18	发行人
23	贴膜机和防位移回收滚轴	2015210527410	2015/12/16	发行人
24	排风管结构	2015210143586	2015/12/8	发行人
25	半导体防漏操作装置	201521012995X	2015/12/8	发行人
26	接触式图像传感器封装结构	2015209241624	2015/11/18	发行人

(2) 结合发行人确认，经本所律师核查相关权利证书，并通过国家知识产权局“中国及多国专利审查信息查询网站”“<http://cpquery.sipo.gov.cn/>”查询，补充事项期间，发行人及其合并报表范围内境内子公司新增下列专利权维持状态的发明专利：

序号	发明专利名称	专利号	专利申请日	申请人
1	板级封装方法及封装结构	202411896169X	2024/12/20	发行人
2	一种板级封装结构及封装系统	2024118961613	2024/12/20	发行人
3	一种板级封装结构及封装方法、板级封装系统	2024118899260	2024/12/20	发行人
4	板级封装方法及封装结构	2024118918810	2024/12/20	发行人
5	一种板级封装结构及封装系统	2024119009213	2024/12/20	发行人
6	一种板级封装结构及封装方法、板级封装系统	2024118962777	2024/12/20	发行人
7	一种平移式分选机、芯片测试方法和芯片测试设备	2023100751654	2023/2/1	发行人
8	一种半导体分选设备及分选方法	2022111066670	2022/9/9	发行人
9	一种信息交互系统及方法	2021116511986	2021/12/30	发行人
10	一种多层堆叠存储器封装方法及封装结构	2021114943699	2021/12/8	发行人
11	多层堆叠高宽带存储器封装结构及封装方法	2021114969129	2021/12/8	发行人
12	一种多层堆叠高宽带存储器的封装方法及封装结构	2021114960459	2021/12/8	发行人
13	一种多层堆叠芯片封装方法及封装结构	2025114051952	2025/9/29	通富通科
14	一种堆叠芯片的封装方法及封装结构	2023105262955	2023/5/11	通富超威苏州
15	隔离式收发器封装结构及封装方法	2022108979838	2022/7/28	合肥通富
16	一种顶针检测装置及检测方法	202211104460X	2022/9/9	厦门通富

(3) 结合发行人确认，经本所律师核查相关权利证书，并通过国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询网站<http://cpquery.cnipa.gov.cn/>查询，补充事

项期间，发行人及其合并报表范围内境内子公司新增下列美国专利：

序号	专利名称	申请号	申请日	授权公告日	申请人
1	PACKAGING STRUCTURE AND FABRICATION METHOD THEREOF	US17629672	2022/1/24	2025/10/7	发行人、南通通富

2.非专利技术许可使用情况

经发行人确认，补充事项期间，发行人非专利技术许可使用情况无变化。

（六）软件著作权

结合发行人确认，经本所律师核查相关权利证书，补充事项期间，发行人及其合并报表范围内境内子公司新增下列软件著作权：

序号	软件名称	登记号	登记日	著作权人
1	客户报告管理系统	2025SR2247414	2025/11/21	通富苏州
2	Running M&C 设备运行管理系统	2025SR2247426	2025/11/21	通富苏州
3	HMS2 智库系统	2025SR2247428	2025/11/21	通富苏州
4	设备利用率监测系统	2025SR2247539	2025/11/21	通富苏州
5	Cart 电源管理系统	2025SR2247545	2025/11/21	通富苏州
6	设备良率自动跟踪系统	2025SR2247412	2025/11/21	通富苏州
7	SLT 设备布局管理系统	2025SR2247567	2025/11/21	通富苏州
8	自主培训系统	2025SR2247410	2025/11/21	通富苏州
9	硬件更换监测系统	2025SR2247417	2025/11/21	通富苏州
10	元器件管理系统	2025SR2247424	2025/11/21	通富苏州
11	图灵宝典平台	2025SR2249119	2025/11/21	通富苏州
12	Socket insertion system	2025SR2249120	2025/11/21	通富苏州
13	Yield Management System	2025SR2252473	2025/11/21	通富苏州
14	通富超威 93K 测试板卡监测系统	2025SR2249771	2025/11/21	通富苏州
15	半导体验证品管控系统	2025SR2252500	2025/11/21	通富苏州
16	半导体生产线设备问题追踪系统	2025SR2247574	2025/11/21	通富超威苏州

（七）发行人合并报表范围内境外子公司所享有的知识产权

根据马来西亚律师出具的法律意见书并经发行人确认，补充事项期间，发行人合并报表范围内境外子公司享有的知识产权情况无变化。

（八）生产经营设备

结合发行人确认，经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其合并报表范

围内境内子公司新增的重要生产、经营设备（净值在 800 万元人民币以上）情况如下：

序号	设备编号	设备名称	净值 (元)	权利人
1	0E702_024	全自动电镀机	36124670	发行人
2	210000010702	全自动外观检查机 E701-227	9,841,117.50	发行人
3	210000010727	测试机 RS10-1239~1257/1267	20,619,469.02	发行人
4	210000010768	引线键合装置 E04F-308~313	10,189,287.00	发行人
5	210000010894	集成电路编带机 E162-309~324	19,137,600.00	发行人
6	210000011061	全自动研削抛光机 E016-010	11,321,440.00	发行人
7	210000011082	晶圆划片机 E02E-181~188	10,189,296.00	发行人
8	210000011132	测试机 RS10-1268~1276/1278	9,371,681.42	发行人
9	210000011135	测试机 RS10-1277/1279/1290~1295	16,570,796.46	发行人
10	210000011140	光刻机 E701-028/045/084L 改造	14,159,292.04	发行人
11	340000000101	集团 Windows Server 授权	8,888,776.40	发行人
12	340000000104	微软 SERVER 系统及 SQL 软件授权	8,130,721.17	发行人
13	0T_E021_0010	晶圆激光切割机	17,260,733.07	通富通科
14	0T_RS10_0135	集成电路测试机	15,642,464.06	通富通科
15	0T_RS10_0136	集成电路测试机	15,642,464.06	通富通科
16	0T_RS10_0137	集成电路测试机	15,642,464.06	通富通科
17	0T_RS10_0138	集成电路测试机	15,790,500.00	通富通科
18	0T_RS10_0143	集成电路测试机	15,593,600.00	通富通科
19	0T_E011_0015	全自动研削抛光机+贴膜揭膜一体机	13,549,054.42	通富通科
20	0T_RS10_0134	集成电路测试机	11,377,702.66	通富通科
21	0G_E011_0012	全自动晶圆减薄机	10,775,286.00	南通通富
22	0G_E701_0024	化学气相沉积装置	26,506,499.00	南通通富
23	0G_E701_0037	光学成像式晶圆缺陷检测机	23,964,528.00	南通通富
24	0G_E701_0051	物理气相沉积装置	23,470,920.00	南通通富
25	0G_E701_0052	全自动电镀机	38,242,10	南通通富

序号	设备编号	设备名称	净值 (元)	权利人
			3.11	
26	0G_E701_0075	塑封机	18,650,40 0.00	南通通富
27	0G_E701_0105	先进封装光刻机	16,703,53 9.82	南通通富
28	0G_E701_0106	解键机	15,490,80 0.00	南通通富
29	0G_E701_0145	全自动晶圆涂胶机	9,292,035 .40	南通通富
30	0G_E701_0161	全自动电镀机	36,557,68 4.80	南通通富
31	0G_E701_0164	回流焊机	9,533,980 .20	南通通富
32	0G_E701_0184	全自动晶圆蚀刻机	9,669,026 .55	南通通富
33	0G_E701_0193	全自动晶圆去胶机	9,384,070 .80	南通通富
34	0S_E011_0013	全自动研削抛光机	11,373,90 6.00	南通通富
35	0S_E011_0014	全自动研削抛光机	11,781,64 9.80	南通通富
36	0S_E141_0023	超声波探伤检测仪	9,776,224 .00	南通通富
37	0S_E701_0028	先进封装光刻机	16,703,53 9.82	南通通富
38	0S_E701_0030	X 射线机	9,264,450 .00	南通通富
39	0S_E701_0044	热压键合机	17,994,37 2.00	南通通富
40	0S_E701_0058	集成电路编带机	10,170,73 2.00	南通通富
41	0S_E701_0077	热压键合机	21,232,42 2.00	南通通富
42	0S_E701_0084	全自动湿法清洗机	17,868,87 0.00	南通通富
43	0S_E701_0097	回流焊机	9,162,188 .00	南通通富
44	0S_E701_0118	物理气相沉积装置	23,719,41 0.00	南通通富
45	0S_E701_0125	全自动晶圆涂胶机	9,115,044 .25	南通通富
46	0S_E701_0134	晶圆级等离子体清洗机	8,090,544 .20	南通通富
47	0S_E701_0135	晶圆等离子体干法刻蚀机	8,603,760 .00	南通通富
48	0S_E701_0136	回流焊机	9,234,702 .40	南通通富
49	0S_E701_0142	全自动晶圆去胶机	9,384,070 .80	南通通富
50	0S_E701_0144	先进封装晶圆多功能光学测量机	8,132,508 .00	南通通富
51	0S_E701_0146	热压键合机	21,724,49 4.00	南通通富
52	0S_E701_0147	热压键合机	21,724,49	南通通富

序号	设备编号	设备名称	净值 (元)	权利人
			4.00	
53	0S_E701_0149	键合机	16,162,190.00	南通通富
54	0S_E701_0150	物理气相沉积装置	24,090,528.00	南通通富
55	0S_E701_0157	热压键合机	21,724,494.00	南通通富
56	0S_E701_0160	解键机	16,000,540.00	南通通富
57	0S_E701_0173	晶圆激光切割机	23,039,775.00	南通通富
58	0S_E701_0183	全自动半导体封装用除泡烤箱	8,512,546.00	南通通富
59	0S_E701_0186	全自动倒膜机	10,730,100.00	南通通富
60	0S_E701_0190	键合机	17,906,400.00	南通通富
61	210000005133	激光直写光刻机	17,910,000.00	南通通富
62	0Y_E701_0005	自动镭射解键合机	9,734,513.27	通富科技
63	000006000032	封装热压键合设备	16,906,350.40	苏州通富
		合计	1,067,781,510.90	

(九) 车辆

根据发行人提供的有关资料及本所律师核查，补充事项期间，发行人及其合并报表范围内境内子公司新增车辆 2 台，车牌号分别为：苏 FM4172、苏 FU73A9

发行人及其合并报表范围内境内子公司对上述新增车辆拥有合法的所有权。

(十) 股权投资

1.2026 年 3 月 27 日，通富通科的原少数股东南通崇川信创产业投资基金合伙企业（有限合伙）已与发行人签署《股权转让协议》，将其持有的通富通科 13.75% 少数股权全部转让给发行人。2026 年 3 月 30 日，该交易的股权转让对价已完成支付；截至本补充法律意见书出具日，已完成相关工商变更登记。

2.合肥城建投资控股有限公司（以下简称合肥城投）作为国家专项建设基金项目的投资平台，以现金共计 6.6 亿元对合肥通富进行投资，投资期限为 10 年，

项目建设期届满后，合肥城投以减资或公司回购方式实现投资回收。

截至 2025 年 12 月 31 日，合肥通富已偿还合肥城投 6.6 亿元封测产业项目投资款，合肥通富将减少注册资本 6.6 亿元，相关减资手续尚在办理中。

根据《审计报告》并经本所律师核查，结合发行人确认，补充事项期间，除以上信息外，发行人全资子公司、控股子公司及重要参股公司无变化。

（十一）发行人的财产不存在重大产权纠纷及潜在纠纷

经本所律师核查，发行人所持有的上述主要资产相关权属证明、合同、发票、付款凭证等文件及发行人确认，本所律师认为，在补充事项期间，发行人所拥有的上述主要财产的所有权或使用权不存在重大产权纠纷及其他潜在纠纷。

（十二）发行人财产权利的行使

1.根据《审计报告》，发行人在其房屋、土地、设备及其他资产上设定的抵押情况如下：

项 目	期 末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	462,738,516.45	462,738,516.45	冻结质押	信用证保证金、保函保证金、冻结存款等
固定资产	5,467,374,155.83	2,943,545,236.62	抵押	银行借款抵押担保
无形资产	160,853,186.36	123,702,694.78	抵押	银行借款抵押担保
合 计	6,090,965,858.64	3,529,986,447.85		

2.根据发行人确认并经本所律师核查，补充事项期间，发行人及合并报表范围内境内子公司土地及固定资产主要抵押情况无变化。

3.根据马来西亚律师出具的法律意见书并经发行人及 TF AMD 相关人员确认，补充事项期间，发行人合并报表范围内境外子公司的资产无抵押情况。

综上，根据《审计报告》及境外律师出具的法律意见书，并经本所律师核查及发行人书面确认，发行人拥有的上述主要财产均系以合法方式取得，权属清晰

明确，不存在产权纠纷；截至 2025 年 12 月 31 日，除律师工作报告已披露的担保以外，发行人及合并报表范围内子公司不存在其他土地及固定资产抵质押的情况。

（十三）发行人资产租赁情况

1.自 2025 年 9 月 30 日起至本补充法律意见书出具日，根据发行人说明并经本所律师核查，发行人及合并报表范围内子公司新增租赁房屋的情况如下。

序号	承租方	出租方	租赁标的	面积 (m ²)	租赁期限	主要用途
1	通富通科	南通市市北集成电路有限公司	南通市北集成电路产业园3号厂房第二层	11,475.24	2025.11.25-2026.10.24	生产
2	厦门通富	厦门海沧发展集团有限公司	厦门市海沧区海农北里57-58号，72-73号-中沧公寓3#楼、8#楼	15套	2025.11.15-2026.02.14	宿舍
			厦门市海沧区海农北里72-73号-中沧公寓8#楼	4套	2025.12.08-2026.03.07	宿舍
			厦门市海沧区海农北里72-73号-中沧公寓8#楼	3套	2025.10.16-2026.1.15	宿舍
			厦门市海沧区海农北里72-73号-中沧公寓8#楼	8套	2025.11.20-2026.02.19	宿舍
			厦门市海沧区海农北里73号-中沧公寓8#楼	2套	2025.11.01-2026.01.31	宿舍
			厦门市海沧区海农北里72-73号-中沧公寓8#楼	6套	2025.12.05-2026.03.04	宿舍

		厦门市海沧区海农北里73号-中沧公寓8#楼	4套	2025.12.09-2026.03.08	宿舍
		厦门市海沧区海农北里72-73号-中沧公寓8#楼	5套	2025.10.13-2026.1.12	宿舍
		厦门市海沧区海农北里72-73号-中沧公寓8#楼	3套	2025.12.1-2026.2.28	宿舍
		厦门市海沧区海农北里72-73号-中沧公寓8#楼	9套	2025.12.6-2026.3.5	宿舍
		厦门市海沧区海农北里73号-中沧公寓8#楼	1套	2025.12.17-2026.03.16	宿舍
		厦门市海沧区海农北里72-73号-中沧公寓8#楼	4套	2025.11.19-2026.02.18	宿舍
		厦门市海沧区海农北里58号, 72-73号-中沧公寓3#楼、8#楼	7套	2025.12.07-2026.03.06	宿舍
		厦门市海沧区海农北里72号-中沧公寓8#楼	2套	2025.12.21-2026.03.20	宿舍
		厦门市海沧区海农北里72-73号-中沧公寓8#楼	3套	2025.12.26-2026.03.25	宿舍
		厦门市海沧区海农北里57-58号, 72号-中沧公寓3#楼、8#楼	12套	2025.11.10-2026.02.09	宿舍
		厦门市海沧区海农北里58号, 65号-中沧公寓3#楼、5#楼	9套	2025.11.23-2026.02.22	宿舍
		厦门市海沧区海农北里58号-中沧公寓3#楼	2套	2025.12.12-2026.03.11	宿舍
		厦门市海沧区海农北	11套	2025.10.01-2025.12.31	宿舍

			里57-58号, 73号-中沧公寓3#楼、8#楼			
			厦门市海沧区海农北里57-58号-中沧公寓3#楼	5套	2025.11.06-2026.02.05	宿舍
3	通富超威 槟城	Chuah Kong Aik	1B-12B-11, Queens Residences 1, Jalan Bayan Indah, 11900 Bayan Lepas, Penang	950平方英尺	2025.02.01-2026.04.30	宿舍
		Chin Ying Shan	A-33-07, Persiaran Cassia Barat Utropolis, Sinaran, 14110 Batu Kawan, Penang	1,044.00平方英尺	2025.10.01-2026.09.30	宿舍
		Lim Khang Yin	B-25-08, Persiaran Cassia Barat Utropolis, Sinaran, 14110 Batu Kawan, Penang	1,044.00平方英尺	2025.10.13-2026.10.12	宿舍

2.根据发行人说明并经本所律师核查,自律师工作报告出具日至本补充法律意见书出具日,发行人及合并报表范围内子公司无新增租赁设备。

十一、发行人及其合并报表范围内子公司的重大债权债务

(一) 发行人及其合并报表范围内子公司尚在履行的重大合同

1.重大采购合同

发行人根据实际生产需求,与主要供应商建立了稳定的业务合作关系,签订采购框架合同,日常根据客户需求量及安全库存等综合因素向原材料供应商发出物料订单。结合上述业务特点,确定重大采购合同的标准为报告期各期与前五大供应商中原材料供应商签订的截至2025年12月31日正在履行的框架合同,及

截至 2025 年 12 月 31 日正在履行中的采购金额超过 3,000 万元的设备采购合同，
具体更新如下：

(1) 原材料合同

序号	供应商名称	采购产品	签订时间	合同期限
1	Unimicron Technology Corp.	按订单确定	按订单签订	按订单签订
2	Ibiden Co., Ltd.	按订单确定	按订单签订	按订单签订
3	Samsung Electro	按订单确定	按订单签订	按订单签订
4	Nan Ya	按订单确定	按订单签订	按订单签订
5	SHINKO	按订单确定	按订单签订	按订单签订
6	AT&S	按订单确定	按订单签订	按订单签订

(2) 设备采购合同

序号	供应商名称	采购产品	签订时间	合同金额
1	Advantest Corporation	V93000测试机	2025. 12. 17	2, 221. 60 万美元
		V93000测试机	2025. 11. 28	1, 721. 16 万美元
		V93000测试机	2025. 11. 28	1, 073. 00 万美元
		V93000测试机	2025. 11. 28	764. 96万 美元
		V93000测试机	2025. 12. 4	909. 29万 美元
		V93000测试机	2025. 11. 12	1, 728. 21 万美元
2	迪思科科技（中国）有限公司	Fully Automatic Grinder/Polisher、Fully Automatic Multi-Mounter、Fully Automatic laser dicing、Fully Automatic Die Separator	2025. 12. 23	1, 483. 32 万美元
3	ASMPT HONG KONG LIMITED	12"FC Die Bonder	2025.8.22	540.00万 美元
		TCB bonder	2025.1.13	810.00万 美元
		TCB bonder	2024.12.17	1,215.00 万美元
4	华友化工国际贸易（上海）有限公司	Coater and Bonder System	2025.1.9	16.65亿 日元
5	Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.	CMP Reflexion LK 3.0	2024.12.16	430.00万 美元

2. 重大销售合同

对于发行人长期合作的客户，发行人主要采用“框架协议+订单”的合作方式，结合上述业务特点，确定重大销售合同的标准为与报告期各期前五大客户签订的截至 2025 年 12 月 31 日正在履行的框架合同，具体如下：

序号	客户名称	签订主体	销售产品	签订时间	合同期限
1	AMD	通富超威苏州	按订单确定	2016.4.29	自2016年4月29日之日起十年有效
		通富超威槟城	按订单确定	2016.4.29	自2016年4月29日之日起十年有效
2	客户二	通富超威苏州	按订单确定	2020.12.3	长期有效
3	客户一	发行人	按订单确定	2020.1.1	有效期五年，到期后自动续期五年，续期次数不限，除非任何一方在期限届满前90日终止协议
4	联发科	发行人	按订单确定	2025.1.1	有效期一年，到期后自动续期，除非任何一方在期限届满前30日终止协议
5	客户三	合肥通富	按订单确定	2021.12.1	有效期五年
6	无锡晨明科技有限公司	通富超威苏州	按订单确定	2021.6.11	长期有效
7	德州仪器	发行人	按订单确定	2003.12.1	有效期一年，到期后自动延续一年，除非任意一方在期限届满前90日提出终止
8	Socionext Inc.	发行人	按订单确定	2019.5.28	有效期一年，到期后自动延续一年，除非任意一方在期限届满前3个月提出终止
9	意法半导体	发行人	按订单确定	2023.8.2	有效期一年，到期后自动延续一年，除非任意一方在期限届满前3个月提出终止

3. 银行借款合同及担保情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其合并报表范围内子公司正在履行中的借款金额在 1 亿元以上的银行借款合同更新如下：

序号	借款主体	借款银行	借款金额 (万元)	借款期限	抵押担保情况
1	合肥通富	国家开发银行安徽省分行	17,500	2020.12.15-2030.12.15	合肥通富抵押、通富微电、合肥海恒投资控股集团有限公司、合肥兴
2	合肥通富	中国银行股份有限公司合肥	10,000	2021.06.01-2030.12.15	

		分行			泰金融控股（集团）有限公司保证担保
3	合肥通富	中国银行股份有限公司合肥开发区支行	10,000	2025.01.16-2026.01.16	信用
4	厦门通富	国家开发银行厦门市分行	10,000	2021.05.31-2029.02.26	厦门通富抵押、通富微电、厦门海沧投资集团有限公司、厦门海沧发展集团有限公司保证担保
5	厦门通富	国家开发银行厦门市分行	10,000	2020.11.30-2029.02.26	
6	通富通科	中国银行股份有限公司南通分行	12,000	2025.01.24-2026.03.18	信用
7	通富通科	中国工商银行股份有限公司南通港闸支行	12,262.80	2022.09.20-2028.05.30	通富微电保证担保
8	南通通富	中国进出口银行江苏省分行	48,000	2024.06.28-2031.06.21	通富微电保证担保
9	南通通富	国家开发银行江苏省分行	10,000	2021.02.23-2029.09.10	通富微电保证担保、南通通富抵押担保
10	南通通富	中国农业银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.02.20-2027.02.19	信用
11	南通通富	中国农业银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.04.27-2027.04.26	信用
12	通富超威苏州	中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	15,400	2023.01.06-2026.01.04	信用
13	通富超威苏州	中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	10,000	2023.12.04-2026.12.03	信用
14	通富超威苏州	中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	10,000	2025.03.20-2026.03.19	信用
15	通富超威苏州	中国进出口银行江苏省分行	20,000	2025.09.04-2028.07.23	信用
16	通富超威苏州	中国进出口银行江苏省分行	30,000	2024.12.19-2027.01.16	信用
17	通富超威苏州	中国进出口银行江苏省分行	10,000	2024.12.04-2027.12.03	信用
18	通富超威苏州	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	12,005.22	2025.03.31-2026.03.30	信用
19	通富超威苏州	中国建设银行股份有限公司	10,033	2025.06.04-2026.06.03	信用

		苏州工业园区支行			
20	通富超威苏州	招商银行股份有限公司苏州分行	13,300	2023.05.18-2026.02.23	信用
21	通富微电	中信银行股份有限公司南通分行营业部	10,000	2025.03.19-2026.10.02	信用
22	通富微电	中信银行股份有限公司南通分行营业部	10,000	2025.06.17-2026.06.17	信用
23	通富微电	中国银行股份有限公司南通分行	30,000	2025.01.02-2026.11.23	信用
24	通富微电	中国银行股份有限公司南通分行	19,000	2025.07.31-2026.11.23	信用
25	通富微电	中国银行股份有限公司南通分行	13,000	2025.02.21-2026.11.23	信用
26	通富微电	中国银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.02.28-2026.11.23	信用
27	通富微电	中国银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.04.30-2026.04.23	信用
28	通富微电	中国农业银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.01.01-2026.12.28	信用
29	通富微电	中国农业银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.01.09-2027.01.08	信用
30	通富微电	中国民生银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.06.18-2027.06.17	信用
31	通富微电	中国进出口银行江苏省分行	42,000	2024.07.31-2029.07.30	通富微电提供抵押担保、华达集团提供保证担保
32	通富微电	中国进出口银行江苏省分行	20,000	2024.09.09-2026.11.27	通富微电提供抵押担保、华达集团提供保证担保
33	通富微电	中国进出口银行江苏省分行	20,000	2024.09.19-2026.11.27	通富微电提供抵押担保、华达集团提供保证担保
34	通富微电	中国进出口银行江苏省分行	20,000	2024.08.23-2027.03.21	通富微电提供抵押担保、华达集团提供保证担保
35	通富微电	中国进出口银行江苏省分行	20,000	2024.08.08-2027.03.21	通富微电提供抵押担保、华达集团提供保证担保

36	通富微电	中国进出口银行江苏省分行	20,000	2024.03.26-2027.03.21	通富微电提供抵押担保、华达集团提供保证担保
37	通富微电	中国进出口银行江苏省分行	50,000	2025.04.22-2028.04.18	华达集团提供保证担保
38	通富微电	中国建设银行股份有限公司南通分行	18,368	2025.08.19-2035.08.15	信用
39	通富微电	中国建设银行股份有限公司南通分行	12,000	2024.09.27-2026.09.26	信用
40	通富微电	中国建设银行股份有限公司南通分行	10,000	2024.06.20-2026.06.19	信用
41	通富微电	中国建设银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.06.26-2027.06.26	信用
42	通富微电	中国建设银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.07.25-2027.07.25	信用
43	通富微电	中国光大银行股份有限公司南通分行	20,000	2024.03.26-2027.03.25	信用
44	通富微电	中国光大银行股份有限公司南通分行	10,000	2024.08.29-2027.08.28	信用
45	通富微电	中国工商银行股份有限公司南通分行营业部	30,000	2025.01.01-2027.01.01	信用
46	通富微电	中国工商银行股份有限公司南通分行营业部	20,000	2024.07.31-2026.07.31	信用
47	通富微电	中国工商银行股份有限公司南通分行营业部	10,000	2024.07.31-2026.07.31	信用
48	通富微电	中国工商银行股份有限公司南通分行营业部	10,000	2024.09.30-2026.09.29	信用
49	通富微电	招商银行股份有限公司南通分行	20,000	2024.10.12-2026.02.12	信用
50	通富微电	招商银行股份有限公司南通分行	20,000	2024.08.15-2026.02.13	信用
51	通富微电	招商银行股份有限公司南通	12,000	2025.09.22-2027.09.21	信用

		分行			
52	通富微电	招商银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.02.27-2027.02.27	信用
53	通富微电	兴业银行股份有限公司南通城东支行	20,000	2025.02.21-2027.02.20	信用
54	通富微电	兴业银行股份有限公司南通城东支行	10,000	2025.04.29-2027.04.28	信用
55	通富微电	兴业银行股份有限公司南通城东支行	10,000	2025.03.27-2027.03.26	信用
56	通富微电	交通银行股份有限公司南通分行	20,000	2024.09.29-2026.09.28	信用
57	通富微电	交通银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.05.20-2026.12.26	信用
58	通富微电	交通银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.05.29-2026.12.26	信用
59	通富微电	交通银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.07.15-2026.12.26	信用
60	通富微电	交通银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.06.13-2026.12.26	信用
61	通富微电	江苏银行股份有限公司南通崇川支行	10,000	2025.09.19-2026.09.18	信用
62	通富微电	国家开发银行江苏省分行	15,596.11	2024.12.25-2027.12.17	信用
63	通富微电	中国工商银行股份有限公司南通分行营业部	20,000	2025.10.22-2027.10.20	信用
64	通富微电	华夏银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.12.18-2027.12.17	信用
65	通富微电	中国建设银行股份有限公司南通分行	10,000	2025.12.23-2027.12.23	信用
66	通富微电	国家开发银行江苏省分行	19,000	2025.12.26-2028.12.25	信用
67	通富超威苏州	华侨永亨银行(中国)有限公司苏州分行	17,695.42	2025.12.12-2026.06.12	信用
68	通富超威槟城	Malayan Banking Berhad	1,945.52 万美元	2025.12.05-2026.01.07	信用

69	通富超威 槟城	Malayan Banking Berhad	2, 500. 00 万美元	2025. 12. 01-2026. 01. 02	信用
70	钜天投资	招商银行股份 有限公司苏州 分行	44, 800. 00	2025. 5. 21- 2028. 2. 17	通富微电提供保 证担保
71	钜天投资	招商银行股份 有限公司苏州 分行	30, 000. 00	2025. 10. 28- 2027. 10. 28	通富微电提供保 证担保
72	通富超威 槟城	Hong Leong Bank Berhad	4, 500万美 元	2024. 02. 20-2034. 01. 28	信用

4.建筑、装修工程合同

截至2025年12月31日，发行人及其子公司正在履行的1,000万元以上的建筑装修工程合同更新如下：

序号	供应商名称	签订主体	合同内容	签订时间	合同金额 (万元)
1	中建八局东南建设有限公司、中建八局第一建设有限公司	厦门通富	集成电路先进封装测试产业化基地（一期）扩产项目/1#厂房3F装修工程	2025. 4. 1	5, 352. 68
2	南通安装集团股份有限公司	通富通科	集成电路测试中心项目-厂房3一层内装修工程	2025. 7. 10	1, 246. 00
3	南通安装集团股份有限公司	通富通科	集成电路测试中心项目-厂房3三层机电安装工程	2025. 10. 21	3, 050. 00
4	南通安装集团股份有限公司	南通通富	超大尺寸Fan-out先进封装技术研发与产线建设项目-厂房3A改造工程	2023. 10. 28	6, 430. 00
5	南通安装集团股份有限公司	南通通富	射频集成电路封装测试生产线建设项目-厂房3A改造机电安装工程	2024. 3. 5	4, 950. 00
6	南通安装集团股份有限公司	南通通富	基于硅转接板的2.5D先进封装技术升级和产能提升项目-厂房3A三层改造机电安装工程	2024. 11. 9	3, 790. 33
7	江苏港林基础工程有限公司	南通通富	集成电路先进封装测试三期厂房3B建设项目桩基工程	2024. 10. 22	2, 980. 00
8	江苏凯祥环境工程有限公司	南通通富	超大尺寸Fan-out先进封装技术研发与产线建设项目-动力2、化学品库2、特气站3、危废库及室外机电安装工程	2023. 10. 28	2, 500. 00
9	上海晶节建筑工程有限公司	南通通富	南通通富微电子有限公司5G等新一代通信用集成电路封装测试项目外墙工程	2022. 12. 28	1, 120. 00
10	Kide International Sdn. Bhd.	通富超威槟城	BKF Bumping Cleanroom Work	2023. 11. 20	12, 113. 00 万马来西亚令吉

11	Kide International Sdn. Bhd.	通富超威槟城	Proposed Level 1 Production Facilitisation, 2 Storey New Building And 1 Storey New Platform With 5 Storey Piling Foundations For FOED	2024. 05. 15	6, 250. 00 万马来西亚令吉
12	Kide International Sdn. Bhd.	通富超威槟城	Proposed Level 3 Production Facilitation At Plot P336, Persiaran Cassia Selatan 8, Taman Perindustrian Batu Kawan, Mukim 13, Batu Kawan, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang.	2025. 10. 11	6, 200. 00 万马来西亚令吉
13	鸿辉系统集成科技(江苏)有限公司	通富苏州	苏州新工厂一期A2生产厂房二楼TMP车间及辅房机电安装工程	2024. 05	4, 030. 65
14	江苏凯祥环境工程有限公司	通富苏州	苏州新工厂一期A4仓库、A5动力厂房机电安装工程	2024. 06	3, 330. 00
15	南通幸福建设集团股份有限公司	通富苏州	苏州通富66#生产厂房1生产厂房2仓库1及连廊土建工程	2023. 07. 22	11, 480. 00
16	南通幸福建设集团股份有限公司苏州分公司	通富苏州	苏州新工厂一期室外市政工程	2024. 08. 27	1, 800. 00
17	南通幸福建设集团股份有限公司	通富苏州	苏州新工厂一期阶段建设项目建筑装修及A6、A7门卫房、管廊工程	2024. 01. 22	1, 365. 58
18	上海晶节建筑工程有限公司	通富苏州	通富苏州新工厂一期一阶段建改项目外墙及门窗工程	2024. 04	1, 688. 00
19	南通四建集团有限公司	通富超威苏州	一区苏州通富超威半导体有限公司(研发办公楼)含人防工程新建项目	2022. 08. 16	4, 747. 32
20	江苏苏净工程建设有限公司	通富苏州	通富超威(苏州)微电子有限公司苏州新工厂A2生产厂房一层洁净室及辅房机电安装工程	2025. 11	6, 080. 00

(二) 发行人及其合并报表范围内子公司尚在履行的知识产权相关协议

根据发行人确认,除律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”中第(二)节“发行人与关联方之间的重大关联交易”外,补充事项期间,发行人及其合并报表范围内子公司其他尚在履行的知识产权相关协议情况无变化。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）发行人设立后的重大资产变化及收购兼并

1. 发行人股本变动

经本所律师核查并经公司确认，补充事项期间，发行人股本无变动。

2. 经本所律师核查并经公司确认，补充事项期间，发行人未发生合并、分立、减少注册资本行为。

3. 合肥通富减资

合肥城建投资控股有限公司（以下简称合肥城投）作为国家专项建设基金项目的投资平台，以现金共计 6.6 亿元对合肥通富进行投资，投资期限为 10 年，项目建设期届满后，合肥城投以减资或公司回购方式实现投资回收。

截至 2025 年 12 月 31 日，合肥通富已偿还合肥城投 6.6 亿元封测产业项目投资款，合肥通富将减少注册资本 6.6 亿元，相关减资手续尚在办理中。

4. 通富通科股权收购

2026 年 3 月 27 日，通富通科的原少数股东南通崇川信创产业投资基金合伙企业（有限合伙）已与发行人签署《股权转让协议》，将其持有的通富通科 13.75% 少数股权全部转让给发行人。

2026 年 3 月 30 日，该交易的股权转让对价已完成支付；截至本补充法律意见书出具日，已完成相关工商变更登记。

（二）发行人拟进行的收购、资产置换、资产剥离及资产出售行为

经发行人书面确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人没有进行资产收购、资产置换、资产剥离、资产出售等行为的意向。

综上，本所律师认为，发行人设立至今发生股本变动、重大资产变化及收购

兼并的行为、操作程序均符合当时法律法规和规范性文件的规定，且已履行必要的法律手续。

十三、发行人章程的制定与修改

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充事项期间，发行人章程有如下修订：

2025年12月15日，发行人召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，发行人根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

经本所律师核查发行人前述股东会的签到册、表决票、会议记录、会议决议等文件，发行人章程修改均已履行了法定程序，且均获得了商务主管部门核准，并且办理了工商备案登记。

十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会、专门委员会议事规则及规范运作

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充事项期间，发行人共计召开1次股东会、2次董事会、2次监事会，具体情况如下：

序号	会议届次	时间	议案
1	2025年第二次临时股东会	2025年12月15日	议案1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 议案3 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 议案4 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

			<p>议案5 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>议案6 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>议案7 《关于修订〈经济担保制度〉的议案》</p> <p>议案8 《关于制定〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>议案9 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》</p>
2	第八届董事会第14次会议	2025年10月24日	议案1 公司2025年第三季度报告
3	第八届董事会第15次会议	2025年11月28日	<p>议案1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>议案2 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>议案3 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>议案4 关于修订《信息披露管理办法》的议案</p> <p>议案5 关于修订《关联交易管理办法》的议案</p> <p>议案6 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>议案7 关于修订《经济担保制度》的议案</p> <p>议案8 关于修订《募集资金管理办法》的议案</p> <p>议案9 关于修订《总裁工作细则》的议案</p> <p>议案10 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案</p> <p>议案11 关于修订《子公司管理制度》的议案</p> <p>议案12 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案</p> <p>议案13 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>议案14 关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案</p> <p>议案15 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>议案16 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案</p> <p>议案17 关于制定《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案</p> <p>议案18 关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案</p> <p>议案19 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案</p>
4	第八届监事会第十次会议	2025年10月24日	议案1 公司2025年第三季度报告

5	第八届监事会第十一次会议	2025年11月28日	议案1 关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案
---	--------------	-------------	----------------------------------

经核查，本所律师认为，截至2025年12月31日，发行人上述股东（大）会的召集、召开、表决程序符合当时法律法规和规范性文件的规定，发行人上述董事会、监事会的召开亦符合当时法律法规和规范性文件的规定。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

截至2025年12月31日，发行人已于2025年12月15日取消监事会；2025年12月26日，发行人召开六届三次职工代表大会，选举了李金健为第八届董事会职工代表董事。

十六、发行人及其合并报表范围内子公司的税务

（一）发行人及其合并报表范围内子公司执行的税种与税率

2023年度、2024年度发行人及其合并报表范围内子公司执行的税收和税率已在律师工作报告中详细陈述。根据《审计报告》，发行人及其合并报表范围内子公司2025年度执行的主要税种、税率情况如下：

主要税种及税率

税种	计税依据	适用税率%
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6、9、13
马来西亚服务税（“Service Tax”）	应税支出	6
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、16.50、20、24、25

不同纳税主体企业所得税税率情况：

纳税主体名称	所得税税率%
--------	--------

本公司、通富超威苏州、南通通富、合肥通富、通富通科、厦门通富	15.00
南通金润	20.00
上海森凯、富润达、通润达、南通通富科技、通富微电科技、通富苏州、通富通达	25.00
通富超威槟城、FSB公司（注1）	24.00
海耀实业、钜天投资（注2）	16.50

注1：通富超威槟城、FSB公司经营地在马来西亚，法定税率为24%。

注2：海耀实业、钜天投资经营地在香港，利得税率为16.50%。

根据发行人确认，结合《审计报告》并经本所律师核查发行人及其合并报表范围内境内子公司 2025 年度主要执行税种的纳税申报表和税收缴款书，发行人及其合并报表范围内境内子公司 2025 年度执行的主要税种、税率符合法律法规和规范性文件的要求。

（二）发行人及其合并报表范围内子公司的税收优惠及其依据

2023 年度、2024 年度发行人及其合并报表范围内子公司的税收优惠及其依据已在律师工作报告中详细陈述，经本所律师补充核查，2025 年度发行人及其合并报表范围内子公司的税收优惠及其依据如下：

发行人于2023年12月13日取得编号GR202332010377的高新技术企业证书，有效期三年，2025年度执行15%的企业所得税率。

通富超威苏州于2025年11月取得编号GR202532001726的高新技术企业证书，有效期三年，2025年度执行15%的企业所得税率。

南通通富于2024年12月取得编号GR202432010851的高新技术企业证书，有效期三年，2025年度执行15%的企业所得税率。

合肥通富于2025年12月取得编号GR202234005843的高新技术企业证书，有效期三年，2025年度执行15%的企业所得税率。

通富通科于2025年12月取得编号GR202532006326的高新技术企业证书，有效期三年，2025年度执行15%的企业所得税率。

厦门通富于2024年11月取得编号GR202435100724的高新技术企业证书，有效期三年，2025年度执行 15%的企业所得税率。

南通金润符合小型微利企业的认定标准，2025年度适用20%的企业所得税优惠税率。

通富超威槟城在2022年3月4日申请5年免税优惠政策，并于2022年4月15日收到MIDA的批复函，基于通富超威槟城生产的高级集成电路产品并运行半导体相关服务活动，如晶圆级芯片规模封装（WLCSP）、晶圆测试等享受未来五年的免税优惠政策。MIDA提出系列条件，并在批复函中要求通富超威槟城在本批复函发出之日起二十四个月内申请税务免税优惠生效日期，申请必须提交到MIDA属下许可和津贴合法监管部门。通富超威槟城对2025年度应缴税款的计算，是建立在自2023年1月1日起即享有之后五年免税优惠期的基础上计算的。

发行人、南通通富、合肥通富、通富通科、厦门通富及通富超威苏州经营“客供料进料加工”业务，出口商品增值税实行“免、抵、退”办法。

（三）重要财政补贴及其依据

经发行人书面确认并经本所律师核查，补充事项期间，发行人及合并报表范围内境内子公司 300 万以上的财政补贴及依据如下：

厦门通富：

获得时间	项目名称	金额（元）	依据文件
2025年12月16日	2025年集成电路产业发展专项资金余款	4,270,000.00	《厦门市工业和信息化局关于下达2025年集成电路产业发展专项资金的通知》（厦工信电子函[2025]143号）
2025年12月22日	中央外经贸发展专项厦门电子信息产业提质增效示范项目2025年度补助资金	3,300,000.00	《厦门市商务局 厦门市财政局关于印发中央外经贸发展专项厦门电子信息产业提质增效示范项目资金管理实施细则的通知》（厦商务[2023]326号）

南通通富

时间	补助项目	金额（元）	依据文件
2025年10月30日	苏锡通科技产业园区（经发局）芯粒产业链核心技术攻关资金	40,000,000.00	文件一
2025年12月18日	TSV 背面显露技术与凸块堆叠技术开发	3,562,000.00	《关于“十四五”国家重点研发技术“微纳电子技术”重点专项2023年度定向指南项目立项的通知》（国科高发技字[2023]66号）
2025年12月30日	苏锡通科技产业园区（经发局）芯粒产业链核心技术攻关资金	180,720,000.00	文件二
2025年12月30日	苏锡通科技产业园区（经发局）先进技术研发及产线建设项目资金	29,080,000.00	文件三

注：根据发行人说明，上表中“文件一”“文件二”“文件三”财政补贴依据文件系发改委保密项目，发行人无相关文件。

苏州通富超威：

时间	补助项目	金额（元）	依据文件
2025年12月15日	投促委数币付数币产业专项资金	6,100,100.00	《苏州工业园区产业发展资金申请表》
2025年12月4日	规建委数币付苏州通富超威半导体电力补贴	26,276,745.63	《供电补贴审核订案单》《会议纪要》（[2021]83号）
2025年12月17日	经发委数币付园区有效投入奖补资金	3,899,900.00	《苏州工业园区支持制造业企业有效投入奖补资金申请表（项目实施期为2023年度）》

经发行人说明及本所律师核查上述发行人及境内合并报表范围内子公司300万以上财政补贴依据文件、到账凭证，上述发行人及其合并报表范围内境内子公司上述享受的主要税收优惠、财政补贴均符合法律法规和规范性文件的规定。

（四）纳税义务履行与处罚情况

根据发行人及其合并报表范围内境内子公司提供的纳税申报表、税收缴纳凭证以及专项信用报告（替代无违法违规证明版）并基于发行人书面确认，截至2025年12月31日，发行人及其合并报表范围内境内子公司近三年依法履行了

各项纳税义务，不存在重大税收违法行为及已受或应受对本次发行构成实质性影响的行政处罚的情形。

综上所述，本所律师认为，截至 2025 年 12 月 31 日，近三年发行人及其合并报表范围内境内子公司执行的税种、税率符合现行法律法规和规范性文件的要求，其所享受的优惠政策、财政补贴均符合法律法规和规范性文件的规定。发行人及其合并报表范围内境内子公司近三年履行了各项纳税义务，不存在重大税收违法行为及已受或应受对本次发行构成实质性影响的行政处罚的情形。

十七、环境保护、产品质量和技术监督

（一）发行人及其合并报表范围内境内子公司生产经营的环境保护

1. 发行人及其合并报表范围内境内子公司持有的排污许可证

经发行人说明并本所律师核查，补充事项期间，发行人及其合并报表范围内境内子公司持有的排污许可证无变化。

2. 根据发行人及合并报表范围内子公司专项信用报告（替代无违法违规证明版），并经本所律师核查“国家生态环境部” <http://www.mee.gov.cn/>、“江苏省生态环境厅” <https://sthjt.jiangsu.gov.cn/>、“安徽省生态环境厅” <https://sthjt.ah.gov.cn/>、“南通市生态环境局” <https://sthjj.nantong.gov.cn/>、“合肥市生态环境局” <http://sthjj.hefei.gov.cn/>、“苏州市生态环境局” <http://sthjj.suzhou.gov.cn/>、“上海市生态环境局” <https://sthj.sh.gov.cn/>、厦门市生态环境局 https://sthjj.xm.gov.cn/zwgk/gsgk/xzcf/202405/t20240515_2846692.htm 等环保相关网站，并基于发行人书面确认，补充事项期间，发行人及其合并报表范围内境内子公司遵守国家环境保护方面的法律法规，不存在因违反环境保护法律法规而受到重大行政处罚的情形。

（二）发行人及其合并报表范围内境内子公司的产品质量和技术监督

经本所律师核查及发行人书面确认，并基于专项信用报告（替代无违法违规证明版），经本所律师核查“国家企业信用信息公示系统”<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>等相关网站，并基于发行人书面确认，补充事项期间，发行人及其合并报表范围内境内子公司不存在因违反有关市场监管方面的法律法规而受到重大处罚的情形。

（三）发行人合并报表范围内境外子公司的环境保护、产品质量和技术监督

根据 TF AMD 相关人员陈述并经发行人书面确认，TF AMD 新增两个证书：

（1）FARAH HAZWANI BINTI HUSAIN 持有的安全与健康官员注册证（Pegawai Keselamatan dan Kesehatan），有效期自 2025 年 11 月 24 日至 2028 年 11 月 23 日；（2）FARAH HAZWANI BINTI HUSAIN 持有的 COMPETENT PERSON CERTIFIED ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL IN SCHEDULED WASTE MANAGEMENT (CePSWaM)。

根据马来西亚律师 2026 年 2 月 2 日出具的法律意见书，且根据发行人说明确认，截至 2025 年 12 月 31 日，TF AMD 与 FSB 获得的所有许可证、证书、执照和批文均有效存续；TF AMD 未被有关部门罚款或下发不合规通知。

经核查，本所律师认为，发行人及其合并报表范围内子公司生产经营活动和募集资金投资项目符合环境保护要求，近三年不存在因违反环境保护方面的法律法规和规范性文件或市场监管方面的法律法规而受到重大处罚的情形。

十八、发行人的劳动人事及社会保障

（一）发行人及其合并报表范围内境内子公司劳动人事及社会保障情况

根据发行人确认并经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其合并报表范围内境内子公司中有劳动者的主体为发行人、南通通富、通富通科、通富科技、通富苏州、通富超威苏州及合肥通富、厦门通富，其他合并报表范围内的境内子公司无劳动者。

根据发行人确认并经本所律师核查员工花名册、劳动合同范例、劳务派遣合同、外包合同、缴纳社保公积金凭证等，发行人及合并报表范围内有用工的企业均与员工依法签署劳动合同；在补充事项期间，南通通富存在劳务派遣用工比例为 6.69%，且用工均系临时性、辅助性、可替代性岗位，完成整改。其余用工主体无劳务派遣比例超过 10% 情形。

根据本所律师对发行人及合并报表范围内子公司的《信用报告（替代无违法违规证明版）》的核查，在补充事项期间，发行人及合并报表范围内子公司未因违反劳动法律法规和不缴纳社会保险费（公积金）的原因而受到行政处罚。

经本所律师核查上述用工主体在“人社通”南通市、苏州市、合肥市、厦门市范畴的处罚记录，在补充事项期间，前述主体不存在因违反劳动法律法规而受到行政处罚的情形。

（二）发行人合并报表范围内境外子公司劳动人事及社会保障情况

根据发行人说明并经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人合并报表范围内境外子公司中具有生产经营的用工主体为通富超威槟城。

根据马来西亚律师出具的法律意见书并经发行人说明确认，截至 2025 年 12 月 31 日，通富超威槟城未被有关部门罚款或下发不合规通知；FSB 不存在用工。

综上，本所律师认为，发行人及其合并报表范围内子公司在补充事项期间劳动人事及社会保障方面不存在重大违法违规行为。

十九、发行人募集资金的运用

（一）发行人本次向特定对象发行募集资金投向

根据发行人第八届董事会第十八次会议决议及相关公告，发行人本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 422,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入
1	存储芯片封测产能提升项目	88,837.47	80,000.00
2	汽车等新兴应用领域封测产能提升项目	109,955.80	105,500.00
3	晶圆级封测产能提升项目	74,330.26	69,500.00
4	高性能计算及通信领域封测产能提升项目	72,430.77	62,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	105,000.00	105,000.00
合计		450,554.30	422,000.00

注：本次调减公司自发行董事会决议日（第八届董事会第十六次会议决议日，即 2026 年 1 月 9 日）前六个月至今实施或拟实施的财务性投资 18,000.00 万元，拟使用募集资金投入由原方案中的 440,000.00 万元调整至 422,000.00 万元，其中补充流动资金及偿还银行贷款金额由原方案中的 123,000.00 万元调整至 105,000.00 万元。

鉴于本次募集资金总额调减至 422,000.00 万元，公司拟将本次非公开发行募集资金中 105,000.00 万元用于补充流动资金。

经核查，除上述调整外，关于本次募集资金使用基本情况未发生其他变化。

（二）发行人前次募集资金使用状况

根据致同出具的“致同专字（2026）第 110A010275 号”《通富微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，发行人通富微电公司董事会编制的截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则

适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了通富微电公司前次募集资金使用情况。

综上，本所律师认为，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人前次募集资金使用符合有关法律法规和规范性文件的规定。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人及其持股 5%以上股东、合并报表范围内子公司的诉讼、仲裁与行政处罚事项

根据发行人提供的相关资料及说明确认，并经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其持股 5%以上股东、合并报表范围内子公司无新增重大诉讼、仲裁与行政处罚事项。

（二）发行人合并报表范围内境外子公司的诉讼、仲裁、劳资纠纷或调查

根据马来律师出具的法律意见书并经发行人说明确认，补充事项期间，通富超威槟城及 FSB 不存在针对的任何未决或潜在的法律、仲裁或破产程序。

根据香港律师出具的法律意见书，补充事项期间，海耀实业、钜天投资并不存在重大诉讼、仲裁、清盘、破产、行政处罚及其法律程序，以及其董事亦没有破产/个人自愿安排呈请记录。

（三）发行人董事长、总裁、副董事长的诉讼、仲裁与行政处罚事项

根据本所律师核查，补充事项期间，发行人董事长、总裁及副董事长不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、上市公司向特定对象发行证券审核关注要点落实情况

（一）超过五年的前次募集资金（含 IPO 及以后的历次融资）用途是否存在变更

经核查发行人公告、相关议案、决议，本所律师认为，发行人超过五年的前次募集资金用途变更情况均已履行必要的审议程序和信息披露义务。

（二）股东会有效期是否符合相关规定

经本所律师核查发行人公告及本次发行股东会议案、决议，发行人本次向特定对象发行股票决议的有效期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。若发行人已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

本所律师认为，本次再融资股东会决议内容及其决议的有效期限，仅在取得证监会注册后为发行所需而延长，未设置自动延期条款。

（三）募投项目是否符合国家产业政策

经本所律师核查，发行人募投项目在其主营业务范畴，如律师工作报告、法律意见书、补充法律意见书（一）相关章节表述，符合国家产业政策相关法律法规、规范性文件要求；不涉及《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41 号）中列示的产能过剩行业，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的限制类、淘汰类产业，符合国家产业政策要求。

（四）发行人是否尚未取得募投用地

经本所律师核查发行人募投项目租赁合同、土地权证，发行人募投用地具体情况已在律师工作报告第三部分“发行人本次向特定对象发行的实质条件”第(二)节“发行人本次向特定对象发行符合《管理办法》的相关规定”阐述，本次发行的募投项目实施地均为已有租赁厂房、自有土地及厂房，不涉及新增取得土地使用权或租赁土地的情形。

(五) 发行人是否通过非全资控股子公司或参股公司实施募投项目

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，通富通科的原少数股东南通崇川信创产业投资基金合伙企业（有限合伙）已与上市公司签署《股权转让协议》，将其所持有的通富通科 13.75% 少数股权全部转让给通富微电。由此，本次募投项目的实施主体均为发行人全资子公司，不存在通过非全资子公司实施项目的情形，亦不存在据此损害上市公司及中小股东利益的情形。

(六) 发行人财务性投资及类金融业务情况

根据《保荐人关于〈上市公司向特定对象发行证券审核关注要点落实情况表〉的核查情况》及发行人说明，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人合并报表可能与财务性投资及类金融业务相关的会计科目具体如下：

单位：万元

序号	项目	金额	是否包含财务性投资	财务性投资金额
1	货币资金	541,008.15	否	-
2	其他应收款	11,731.39	否	-
3	其他流动资产	53,206.13	否	-
4	长期股权投资	165,743.73	是	17,363.26
5	其他权益工具投资	10,406.25	是	606.78
6	其他非流动金融资产	68,838.65	是	67,344.50

7	其他非流动资产	33,338.11	否	-
财务性投资合计				85,314.54
报告期末合并报表归属于母公司净资产				1,518,047.03
财务性投资占比				5.51%

1.货币资金

截至 2025 年 12 月 31 日,发行人货币资金主要为银行存款和其他货币资金,不属于财务性投资及类金融业务。

2.其他应收款

截至 2025 年 12 月 31 日,发行人其他应收款主要系备用金、保证金、押金等,不属于财务性投资及类金融业务。

3.其他流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日,发行人其他流动资产主要系增值税留抵税额、待认证进项税额等,不属于财务性投资及类金融业务。

4.长期股权投资

截至 2025 年 12 月 31 日,发行人存在长期股权投资 165,743.73 万元,明细如下:

被投资企业	账面价值 (万元)	持股比例	经营范围	是否是财务性投资
合肥通易股权投资合伙企业 (有限合伙)	6,538.83	65.78%	股权投资;创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	是
南通全德学鏊科芯二期创投基金管理合伙企业 (有限合伙)	10,824.43	21.33%	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	是
南通市协同创	27.06	24%	一般项目:技术服务、技术开发、	否

新半导体科技 有限公司			技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；创业空间服务；物联网技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
京隆科技	148,353.40	26%	半导体集成电路、电晶体、电子零组件、电子材料、模拟或混合自动数据处理机、固态记忆系统、升温烤箱及相关产品和零件的研发、设计、制造、封装、测试、加工和维修，集成电路相关技术转让、技术咨询、技术服务，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
合计	165,743.73	-	-	-

南通市协同创新半导体科技有限公司是一家在南通市半导体产业协同创新联合体委托下，以产学研协同创新攻关项目为载体，通过“政、产、学、研、用、金”多方支撑，实体化运行管理的公司，主要任务包括集聚创新资源、组织开展技术攻关、联合实施重大项目、加快科技成果转化等。南通市协同创新半导体科技有限公司从事集成电路技术服务、开发及咨询，与发行人集成电路封测主营业务具有协同性，不属于与发行人主营业务无关的股权投资或不属于财务性投资及类金融业务。

京隆科技为大陆地区客户提供晶圆针测、研磨切割、晶圆级重新封装建构（RW）、芯片封装、芯片终测等全流程芯片封测业务。京隆科技运营模式和财

务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。报告期内，发行人已与京隆科技在技术协同、业务协同等方面开展了实质性业务合作。发行人向京隆科技的投资属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，与发行人开展业务合作，符合发行人主营业务及战略发展方向，不属于与发行人主营业务无关的股权投资，不属于法规中界定的财务性投资及类金融业务。

5.其他权益工具投资

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人其他权益工具投资账面价值为 10,406.25 万元，具体情况如下：

被投资企业	账面价值（万元）	持股比例	经营范围	是否是财务性投资
华进半导体	9,799.47	4.32%	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	否
无锡中科赛新投资合伙企业（有限合伙）	606.78	7.26%	利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	是
合计	10,406.25	-	-	-

注：截至本补充法律意见书出具日，上表中发行人对华进半导体的持股比例已变更为 2.78%。

华进半导体是国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心，通过以企业为创

新主体的产学研用相结合的模式，开展系统封装设计、2.5D/3D 集成、晶圆级扇出封装、大尺寸 FCBGA 封装、光电合封、SiP 封装等关键核心技术研发，为产业界提供知识产权、技术方案、批量生产以及新设备与材料的工艺开发和验证的相关服务。华进半导体与发行人共同承担国家级研发项目、从事先进封装技术的研发，发行人先后参与实施由华进半导体牵头承担的两个国家科技项目，相关项目均已通过验收。华进半导体与发行人主要从事的集成电路封装测试业务具有协同性。发行人投资华进半导体系以提高我国封测产业技术创新能力和核心竞争力为目的，不属于与发行人主营业务无关的股权投资，不属于财务性投资及类金融业务。

6.其他非流动金融资产

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人存在其他非流动金融资产 42,202.29 万元，

明细如下：

被投资企业	账面价值 (万元)	持股比例	经营范围	是否是财务性投资
上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）	9,395.64	9.90%	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	是
上海华虹虹芯二期创业投资合伙企业（有限合伙）	4,008.32	9.00%	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	是
厦门润信汇泽投资合伙企业（有限合伙）	10,028.99	55.56%	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	是
道生天合材料科技（上海）股份有限公司	1,494.15	0.13%	许可项目：危险化学品经营（具体项目详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经	否

			营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事材料科技、风力发电科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，机械设备及配件、电子设备及配件、各类树脂、胶黏剂、涂料配方产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，混配环氧树脂、混配固化剂、胶黏剂的生产，轻木、泡沫制品研发、销售，高性能纤维及复合材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
深圳至正高分子材料股份有限公司	43,911.56	4.40%	销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；无	是
合计	68,838.65	-	-	-

注：2025年，发行人与深圳至正高分子材料股份有限公司签署《资产购买协议之补充协议》，深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份收购公司持有的滁州广泰半导体产业发展基金（有限合伙）和嘉兴景曜企业管理合伙企业（有限合伙）出资额，交易作价合计21,500.00万元，深圳至正高分子材料股份有限公司的股份发行价格为32.00元/股，向公司发行股份数量合计为6,718,750股。截至2025年12月31日，发行人已取得以上深圳至正高分子材料股份有限公司的股权。

2025 年 9 月，发行人通过战略配售，认购了道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行的 0.13% 股份。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司是一家致力于新材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业，拥有环氧树脂完整的产业链研发、生产和制造优势，在风电、新能源汽车、新型复合材料等领域的改性环氧树脂产品已经取得了一定的市场地位。通富微电作为国内半导体芯片封装行业的头部企业，环氧树脂塑封料是日常经营使用的主材之一。通过双方的战略合作，道生天合将借助通富微电对半导体芯片封装用环氧树脂的具体需求、产品应用场景的理解和产业链主的优势，加大半导体芯片封装用环氧树脂等材料的研发、生产和销售，以期在环氧树脂的半导体应用领域取得更多进展，双方将在超高导热、高可靠性、低应力等不同性能的环氧塑封料以及生物基环氧树脂或可回收材料展开合作研究，满足未来国产替代及环保的需求，提升电子制造工艺的可持续性。道生天合材料科技（上海）股份有限公司与发行人主营业务集成电路封测具有协同性，不属于与发行人主营业务无关的股权投资，不属于财务性投资及类金融业务。

7.其他非流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人其他非流动资产主要系预付工程款、设备款、产能保证金，不属于财务性投资及类金融业务。

综上，根据《保荐人关于〈上市公司向特定对象发行证券审核关注要点落实情况表〉的核查情况》、经发行人说明并本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人不存在金额较大的财务性投资及类金融业务的情形，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

二十二、对补充法律意见书（一）相关事项的更新

问题 1:

报告期各期，发行人营业收入分别为 2142857.66 万元、2226928.32 万元、2388168.07 万元和 2011625.89 万元，归属于上市公司股东的净利润分别为 50183.25 万元、16943.85 万元、67758.83 万元和 86049.11 万元，主营业务毛利率分别为 13.58%、11.50%、14.50% 和 14.82%，各期境外收入占比超过 65%。

报告期内，公司向前五大客户合计销售金额占当期销售总额的比例分别为 68.90%、72.62%、69.00% 及 69.73%，各期对客户 AMD 的收入占当期销售总额的比例均超过 50%。发行人控股子公司在马来西亚设有工厂。

发行人部分原材料需要从国外采购，报告期内前五大供应商基本为境外企业。

截至最近一期末，发行人财务性投资占比为 3.80%，不存在持有金额较大的财务性投资的情形。

请发行人补充说明：（1）说明公司 2023 年净利润及主营业务毛利率下降的原因及合理性，与同行业可比公司变动趋势是否一致。（2）报告期内前五大外销客户基本情况，相应境外收入与海关数据、客户回款情况等是否匹配；报告期内客户集中度较高的原因及商业合理性，AMD 作为主要客户未来合作的稳定性，是否存在大客户依赖；结合全球半导体产业链布局变化、贸易政策及出口管制等因素，说明相关因素对发行人境外经营、外销收入的影响。（3）报告期内境外前五大供应商基本情况及采购情况；是否存在依赖进口、相关原材料是否存在国产替代、贸易摩擦及国际关系形势等对公司境外采购的具体影响。（4）报告期末对外投资情况，包括公司名称、认缴金额、实缴金额、初始及后续投资时点、持股比例、账面价值、占最近一期末归母净资产比例、是否属于财务性投资，若未认定为财务性投资的，请结合投资后新取得的与发行人主营业务相关行业资源或新增客户、订单，报告期内发行人与被投资企业主要合作情况等，说明发行人是否仅为获取稳定的财务性收益，认定其不属于财务性投资的理由是否充分；自本次发行相关董事会前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情

况。

请发行人补充披露（2）（3）涉及的相关风险。

请保荐人和会计师核查并发表明确意见，请发行人律师核查（2）（3）并发表明确意见。

一、报告期内前五大外销客户基本情况，相应境外收入与海关数据、客户回款情况等是否匹配；报告期内客户集中度较高的原因及商业合理性，AMD 作为主要客户未来合作的稳定性，是否存在大客户依赖；结合全球半导体产业链布局变化、贸易政策及出口管制等因素，说明相关因素对发行人境外经营、外销收入的影响。

报告期各期，发行人境外收入分别为 1,656,001.68 万元、1,576,475.02 万元和 1,859,383.03 万元，占当期营业收入的 74.36%、66.01%和 66.59%。

（一）报告期内前五大外销客户基本情况，相应境外收入与海关数据、客户回款情况等是否匹配

报告期各期，发行人向境外前五大客户销售收入分别为 1,502,904.21 万元、1,427,976.07 万元和 1,711,534.19 万元，占当期营业收入的 67.49%、59.79%和 61.30%。

报告期各期，发行人向境外前五大客户销售收入分别为 1,502,904.21 万元、1,427,976.07 万元和 1,711,534.19 万元，占当期营业收入的 67.49%、59.79%和 61.30%。

报告期各期，若合并计算来自境外客户及其境内控制主体的主营业务销售金额，发行人前五大外销客户共有 6 名。除 AMD 以外，来自其余客户主营业务收入金额与报关数据差异较小，与海关数据具有较强匹配性。AMD 存在一定差异，主要系结算模式差异和补偿款项模式差异所致，符合双方之间商业实质。

报告期各期末，发行人前五大境外客户的应收账款，均在各期资产负债表日后一年以内回款，期后回款情况良好，截至 2026 年 3 月 31 日，发行人报告期末对上述前五大境外客户的应收账款均已完成回款。发行人境外收入与销售回款的匹配性较强。

（二）报告期内客户集中度较高的原因及商业合理性，AMD 作为主要客户未来合作的稳定性，是否存在大客户依赖

1、报告期内客户集中度较高的原因及商业合理性

报告期内，公司向前五大客户合计销售金额占当期销售总额的比例分别为 72.62%、69.00% 及 69.54%。报告期各期公司第一大客户均为 AMD，2023 年、2024 年、2025 年，公司向其销售金额分别为 1,322,444.84 万元、1,202,544.29 万元、1,460,043.52 万元，对其销售金额占公司营业收入的比重分别为 59.38%、50.53%、52.29%，导致发行人客户集中度相对较高。

报告期内，部分封装测试企业营业收入集中度较高，如长电科技向前五大客户销售总额占比分别为 50.68%、52.32%、48.80%；盛合晶微向前五大客户销售总额占比分别为 87.97%、89.48%、90.87%（2025 年 1-6 月数据）。发行人客户集中度情况与同行业公司不存在显著差异。

发行人向 AMD 销售收入占比相对较高的原因具体如下：

(1) 封测服务具有定制化特点，AMD 等头部厂商一般选择少量供应商进行长期合作

在集成电路领域，不同客户设计的芯片功能不同，这就要求封测厂商须根据不同客户产品的具体质量、性能标准，相应选择生产线的工艺参数，提供定制化的封测服务。以 AMD 为代表的主要客户的产品从研发设计到最终进入市场，需要通过多重的样品测试和认证，而客户每更换一次产品设计或者封装形式，都要付出一定的成本。封测服务定制化的特点决定了客户粘性较强，客户一般不会轻易更换现有的合格供应商。从产品技术配套、服务响应能力、供应商体系更换成本等多方面因素考量，公司与 AMD 的合作具有较强的长期稳定性。报告期内，公司始终是 AMD 最主要的封测供应商，公司控股子公司通富超威苏州、通富超威槟城承接了 AMD 所需的多数封测服务，交易占比较高。

(2) 发行人在高端封测领域的技术能力与交付能力，为与客户的合作奠定了稳固的基础

发行人目前拥有 Bumping、WLCSP、FC、SiP、Chiplet 等先进封装技术，QFN、QFP、SO 等传统封装技术，以及圆片测试、系统测试等测试技术。发行人已具备 5 纳米、7 纳米、晶圆级封装、存储、Driver IC、车载电子等产品的技术及大规模生产能力。公司卓越的研发实力、规模化的产能优势和丰富的封测经验为公司与客户的合作奠定了稳固的基础。

发行人与 AMD 等主要客户在高端封装、先进工艺、产品迭代等方面形成长期深度协同。封测客户在完成产线认证、质量审核及技术匹配后，通常倾向于保持稳定、集中的供货关系，以保障产品良率、交付效率与供应链安全。客户集中度较高是市场主要客户基于供应商技术水平、交付能力、行业竞争格局的市场化选择结果。

(3) AMD 在报告期内业务发展态势良好，对封测产品拥有持续强劲的需求

作为全球领先的高性能处理器设计公司，报告期各期 AMD 营业收入均超过 200 亿美元，2023 年度因全球半导体市场周期波动影响，AMD 营业收入及净利润有所下滑；2024 年随着全球半导体市场进入上行周期，市场需求回暖，AMD 业绩也随着稳步增长，具体情况详见下表：

单位：亿美元

项目	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	346.39	257.85	226.80	236.01
营业收入增长率	34.34%	13.69%	-3.90%	/
净利润	42.69	16.41	8.54	13.20
净利润增长率	160.15%	92.15%	-35.30%	/

除 2023 年度因全球半导体行业周期下行导致 AMD 营收及利润下降，整个报告期内，AMD 业务发展态势良好。AMD 自身良好的业务发展态势对封测产品拥有持续强劲的需求。在上述背景下，尽管发行人报告期内持续拓展境内外客户并实现了良好的成效，AMD 的销售收入始终占据了发行人销售中的较高比例，发行人的销售集中度总体较高。

综上所述，报告期内，发行人客户集中度较高具有商业合理性。

2、AMD 作为主要客户未来合作的稳定性，是否存在大客户依赖

AMD 作为发行人的主要客户，未来合作具有稳定性，主要原因系：

(1) 发行人与 AMD 已保持多年稳定合作，发行人的技术支持为 AMD 提供了稳定的供应保障

公司成立以来，始终坚持通过持续的技术创新，实时满足客户对技术进步的需求。近年来，AMD 采取“先进架构+先进制程”的策略，在高性能处理器等领域，稳步实现对英特尔的赶超。作为 AMD 的密切合作伙伴，早在 2018 年，公司便已布局 7nm 封测技术研发与应用。2019 年，公司即开始为 AMD 批量提供 7nm 封测产品，为客户 AMD 各类行业领先产品的推陈出新提供了坚实的保障。2020 年以来公司秉承“立足 7nm、进阶 5nm”的发展战略，深入开展 5nm 芯片封装研发，全力配合和支持 AMD 产品的高端进阶。2022 年开始，公司开始为 AMD 提供 5nm 封测产品，凭借 5nm、7nm、FCBGA、Chiplet 等先进技术优势，不断强化与 AMD 的深度合作。

2016 年以来，公司为 AMD 提供了稳定的产品封测供应保障，公司在 GPU、CPU 产品封测领域拥有充足的产能、先进的技术、经验丰富的人才团队，并根据客户需求不断增加投资、扩大产能、引进人才、研发新技术，及时满足 AMD 营收规模增长、产能工序换代对封测服务不断扩大的需求。

(2) 发行人与 AMD 的合作具备高度的技术协同性与业务黏性，符合封测行业集中供货的商业逻辑

封装测试行业具有技术深度绑定、产线定制化程度高、验证周期长、质量体系严苛等行业特点。发行人与 AMD 等主要客户在高端封装、先进工艺、产品迭代等方面形成长期深度协同。封测客户在完成产线认证、质量审核及技术匹配后，通常倾向于保持稳定、集中的供货关系，以保障产品良率、交付效率与供应链安全。上述合作模式是半导体封测领域的普遍商业实践，一般情况下不会轻易更换封测供应商，发行人与 AMD 具有较高的技术协同性与业务黏性，符合封测行业集中供货的商业逻辑。

(3) 发行人与 AMD 形成了“合资+合作”的战略合作伙伴关系，具有共同发展的商业基础

AMD 是全球领先的 CPU、GPU 芯片厂商，公司与 AMD 已经建立长期战略合作关系。2016 年，公司通过并购通富超威苏州和通富超威槟城，与 AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，深度锁定了 AMD 供应链并占据 AMD 封测订单的大部分份额。由于通富超威苏州和通富超威槟城前身为 AMD 内部封测厂，熟悉 AMD 产品的生产及管理流程，对于 AMD 而言，通富超威苏州及通富超威槟城在产品验证、产品质量、产能支撑、新产品开发时间、业务对接效率等方面具有优势。

综上所述，AMD 作为主要客户，与发行人未来合作具有稳定性，不存在发行人单方面依赖重大客户的情形。

3、发行人与 AMD 的合作情况

(1) 通富超威苏州及通富超威槟城与 AMD 合作密切，但并非仅服务于 AMD

报告期内，通富超威槟城主要为 AMD 提供封装测试服务，通富超威苏州除了向 AMD 提供封装测试服务以外，亦存在向其他客户的大批量销售。尽管 AMD 为发行人通富超威苏州及通富超威槟城的主要客户，但上述主体并非专门为 AMD 服务，相关产线、设备及技术平台，可以用于 CPU、GPU 等多种高端 FCBGA 封装，在同一高端封装测试领域内具备通用性，可用于其他使用 FCBGA 封装测试的芯片制造企业。

(2) 发行人具备生产经营相关的知识产权，对 AMD 不存在技术依赖

发行人在收购通富超威苏州及通富超威槟城时，即取得了上述公司的相关技术及知识产权。通富超威苏州及通富超威槟城掌握了相关先进封装技术。根据 AMD 与通富超威苏州及通富超威槟城签署的《知识产权许可协议》，AMD 对通富超威苏州及通富超威槟城在工厂运营设施进行组装、测试、标记、包装和封装服务的过程中实际使用的技术授予非独占、全球的、已全部付清、免费的、不可转让、永久和不可撤销的许可，即通富超威苏州及通富超威槟城可以永久地无偿使用其在前次收购前使用的 AMD 相关的所有技术。

收购完成后，通富超威苏州及通富超威槟城研发形成的相关技术和专利，归上述子公司独立享有。截至 2025 年 12 月 31 日，发行人专利申请量累计突破达 1,779 件，其中发明专利申请占比约 70%，专利授权突破 800 件，曾连续 3 年获得中国专利奖优秀奖。技术研发能力是公司的核心竞争力。

综上所述，发行人子公司通富超威苏州及通富超威槟城拥有生产经营相关的知识产权。

(3) AMD 订单规模下降会对发行人经营造成阶段性影响，但发行人具备应对措施

短期而言，若 AMD 向发行人发出的订单规模下降，存在客户切换的成本从而对生产经营造成不利影响。虽然通富超威苏州及通富超威槟城的高端 FCBGA 封装测试相关产线、设备及技术平台具有通用性，发行人可以将空出的产能转移至其他使用高端 FCBGA 封装的客户。但切换客户时，发行人需要调整产线工艺参数、更换调试测试程序、生产验证封测样品等。根据新产品的复杂度，切换周期一般在 4-10 周不等，短期内会给公司造成不利影响。

假设 AMD 订单规模出现波动或下降，订单下降幅度为 5% 或 10%，且发行人未能及时取得新订单填补产能，订单波动对发行人经营业绩及产能利用率的具体影响测算如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
营业收入（万元）	2,792,142.47	2,388,168.07	2,226,928.32
毛利金额（万元）	407,254.31	354,512.06	259,814.64
产能利用率	88.41%	78.95%	67.12%
假设AMD订单量下降5%			
营业收入（万元）	2,719,140.29	2,328,040.86	2,160,806.08
下降幅度	-2.61%	-2.52%	-2.97%
毛利金额（万元）	386,064.76	336,723.41	241,818.53
下降幅度	-5.20%	-5.02%	-6.93%
产能利用率	88.40%	78.94%	67.11%
下降幅度	-0.01%	-0.01%	-0.01%
假设AMD订单量下降10%			
营业收入（万元）	2,646,138.11	2,267,913.64	2,094,683.84
下降幅度	-5.23%	-5.04%	-5.94%
毛利金额（万元）	364,875.20	318,934.75	223,822.42
下降幅度	-10.41%	-10.04%	-13.85%

项目	2025年度	2024年度	2023年度
产能利用率	88.38%	78.93%	67.10%
下降幅度	-0.03%	-0.02%	-0.02%

注：1、假设发行人向AMD销售的收入与订单数量下降的比例相同，AMD相关固定成本占比以通富超威苏州及通富超威槟城的固定成本占比模拟测算；

2、发行人的产出的产品形态包括芯片（颗）和晶圆（片）两种，其中AMD涉及的产品形态以芯片（颗）为主，上表中仅统计并测算芯片（颗）形态的产能利用率及其变动比例，并非发行人全部产能的利用率。

根据上表测算，若AMD订单量下降5%、10%，发行人的营业收入、毛利金额均将受到一定程度的影响，其中，若AMD订单量下降5%，发行人营业收入将下降2.97%、2.52%和2.61%（按报告期各期数据分别测算，下同），毛利金额将下降6.93%、5.02%和5.20%，若AMD订单量下降10%，发行人营业收入将下降5.94%、5.04%和5.23%，毛利金额将下降13.85%、10.04%和10.41%；由于AMD采购的封装测试服务均系先进封装中的FCBGA封装，单个芯片面积较大、价值较高、数量相对较少，其订单减少对发行人整体产能利用率的影响相对较低。

长期而言，凭借发行人的技术、品牌、客户积累等优势，发行人具备应对风险的能力。发行人在封装测试领域长期发展和沉淀，已积累了优质的客户储备，并与境内外多家知名芯片设计企业保持良好的商业关系。发行人将释放原先服务AMD的人力、物力等资源转向其他龙头客户，积极开发新客户资源，逐步获取新订单并完成产线切换，以充分利用相关产线，可以有效缓解或消除上述AMD订单规模波动或下降产生的不利影响。

报告期内，发行人不存在对单一客户的重大依赖。由于公司来自AMD的收入占比在报告期内相对较高，若今后AMD经营状况出现较大变动，导致AMD自身对于封装及测试的需求量减少，则将会对公司经营业绩产生一定影响。发行人在本次发行的募集说明书中披露“客户集中度较高的风险”，具体如下：

“2023年、2024年和2025年，发行人来自前五大客户的收入占比分别为72.62%、69.00%和69.54%，占比相对较高。

发行人控股子公司通富超威苏州及通富超威槟城原系AMD下属专门从事封

装与测试业务的子公司，主要用于承接 AMD 内部的芯片封装与测试业务。发行人 2016 年完成对通富超威苏州及通富超威槟城的收购后，将其从 AMD 的内部封测厂商转型成为面对国内外具有高端封测需求客户开放的 OSAT 厂商。近年来，发行人来自 AMD 及其他客户的订单量均有较大幅度的增长；但从客户收入占比角度看，短期内 AMD 依然是发行人的第一大客户。

若今后 AMD 经营状况出现较大变动，导致 AMD 自身对于封装及测试的需求量减少，则发行人将由于客户集中度高而面临经营波动的风险。其中，若 AMD 订单量下降 5%，发行人营业收入将下降 2.97%、2.52% 和 2.61%（按报告期各期数据分别测算，下同），毛利金额将下降 6.93%、5.02% 和 5.20%，若 AMD 订单量下降 10%，发行人营业收入将下降 5.94%、5.04% 和 5.23%，毛利金额将下降 13.85%、10.04% 和 10.41%。对此，发行人将继续加强与境内外领先的知名半导体企业合作，积极努力发展其他客户，降低 AMD 的业务占比。”

（三）结合全球半导体产业链布局变化、贸易政策及出口管制等因素，说明相关因素对发行人境外经营、外销收入的影响

1、全球半导体产业链布局变化情况

从全球半导体产业链的整体布局变化情况来看，半导体产业链已历经从美国向日本，再向韩国、中国台湾地区及中国大陆的多轮产业转移。第一次转移发生在 20 世纪 70 年代，由美国转向日本；第二次发生在 20 世纪 80 年代，由日本转向韩国和中国台湾地区。目前，中国大陆正处于新一代智能手机、物联网、人工智能、5G 通信等新兴产业快速崛起的进程中，已成为全球最重要的半导体应用和消费市场之一。在半导体产业加速向中国大陆转移以及国家政策大力支持的背景下，中国半导体产业规模持续扩大，随着国际产能不断向中国转移，国内外半导体企业在境内的产能建设持续加码，进一步推动了国内半导体封装需求的增长。

从封装测试产业链上游配套环节来看，随着国内半导体产业政策稳步推进与本土供应链培育力度加大，封装领域所需的封装基板、框架、塑封料、键合丝等

关键原辅材料，以及封装测试专用设备的国产化替代步伐持续加快，本土配套企业技术实力与供应稳定性逐步提升，已形成覆盖封装全流程的上游支撑体系，有效打破境外供应依赖，为国内封测产业规模化、高质量发展筑牢了坚实的产业基础，产业链上游自主可控水平持续提升。

从封装测试产业链下游应用及整体产业地位来看，国内封测行业依托成熟的产业集群、规模化产能优势与持续的技术研发投入，发行人等头部封测企业先后实现先进封装技术突破并批量应用，产业规模稳居全球前列，市场份额持续稳步提升；同时依托下游算力芯片、汽车电子、消费电子等庞大应用市场需求，形成上下游协同联动的完整生态，在全球封装产业链中的核心竞争力不断增强，产业话语权与整体优势持续巩固，占据了产业链的关键地位。

2、贸易政策及出口管制因素

根据境内主体海关数据统计，发行人主要出口地为自贸区、亚太地区（中国台湾、中国香港、新加坡等），直接向美国出口的比例较低。报告期各期，发行人前五大境外客户中，AMD、德州仪器的注册地位于美国。2022年10月，美国商务部修订《出口管制条例》，从境外芯片直接供应、本土芯片境外制造、半导体制造设备出口、人员参与等方面全方位限制我国人工智能等高性能运算产业。

美国对中国科技产业出口管制政策以先进制程晶圆制造、高性能芯片设计、涉军用途等敏感领域为主，对集成电路产业链中的设计和晶圆制造公司以及电子产品制造企业影响比较明显。发行人封装测试业务不属于上述范畴，受上述管制的影响较为有限。从封装测试企业的业务特点和所处产业链位置的角度分析，集成电路封装测试企业受到相关政策直接影响较小，发行人封装测试后产品从中国大陆直接出口到美国的收入占比较低，报告期各期占比均低于5%，美国上述管制措施对发行人的直接影响较小。

截至报告期末,发行人及国内同行业上市公司(包括长电科技、华天科技等)均未被列入实体清单,美国的贸易政策和出口管制未对发行人产生重大不利影响。

3、相关因素对发行人境外经营、外销收入的影响

报告期内,发行人营业收入的地区构成情况如下:

单位:万元

区域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国境外	1,859,383.03	66.59%	1,576,475.02	66.01%	1,656,001.68	74.36%
其中:美国	1,505,828.35	53.93%	1,242,675.53	52.03%	1,368,958.73	61.47%
欧盟	109,865.49	3.93%	90,036.35	3.77%	103,859.59	4.66%
日本	19,849.32	0.71%	31,563.17	1.32%	60,698.45	2.73%
中国台湾	28,003.79	1.00%	41,778.37	1.75%	35,237.83	1.58%
新加坡	60,166.72	2.15%	51,922.34	2.17%	26,238.93	1.18%
马来西亚	7,669.83	0.27%	1,563.47	0.07%	51.98	0.00%
境外其他	127,999.51	4.58%	116,935.78	4.90%	60,956.17	2.74%
中国境内	932,759.44	33.41%	811,693.05	33.99%	570,926.64	25.64%
合计	2,792,142.47	100.00%	2,388,168.07	100.00%	2,226,928.32	100.00%

注:上述销售的国家和地区以客户集团公司总部的所在地划分,同一控制下的客户合并计算。

报告期各期,发行人境外收入分别为1,656,001.68万元、1,576,475.02万元和1,859,383.03万元,总体呈上升趋势。与发行人整体经营的增长情况基本一致。按照客户集团总部的所在地划分,发行人的境外收入主要来自美国、欧盟、日本等国家和地区的客户及其控制的主体。报告期内,发行人境外收入整体保持稳定,主要境外区域的销售收入未发生重大不利变化。

综上所述,报告期内,境外收入主要来源国的贸易政策及出口管制等情况未对发行人的境外经营、外销收入产生重大不利影响。

发行人于本次发行的募集说明书“重大事项提示”提示之“二、重大风险提示”之“(三)境外市场及国际贸易风险”对贸易政策相关风险补充风险提示。

具体如下:

“报告期各期，发行人境外收入分别为 1,656,001.68 万元、1,576,475.02 万元和 1,859,383.03 万元，占当期营业收入的 74.36%、66.01%和 66.59%。发行人作为封测代工企业，从产业链角度受贸易争端影响较小。未来，如果相关国家与中国的贸易摩擦持续升级，出台不利于发行人外销经营的贸易政策或出口管制措施，如限制进出口或提高关税，发行人可能面临设备、原材料短缺和客户流失等风险，进而导致发行人生产受限、订单减少、成本增加，对发行人的境外业务经营和外销收入产生不利影响。”

（四）核查程序和核查意见

1、核查程序

本所律师主要履行了如下核查程序：

（1）查阅并核对了发行人报告期各期主要境外客户的销售收入、海关报关数据、当期回款及期后回款情况、应收账款余额；获取发行人与 AMD 的合同并检查与收入确认相关的约定；抽样检查发行人与 AMD 的工序对账单，并与账面记录进行核对；针对补偿款项，抽样检查 AMD 订单，并与账面记录进行核对；向 AMD 函证交易金额及应收账款余额。

（2）向发行人了解了报告期内与 AMD 的主要合作模式，分析了客户集中度较高的原因，查询了 AMD 在报告期内的业绩情况。

（3）查阅境外主要主体关于半导体芯片产品进出口管制的有关规定，与发行人了解相关规定的具体影响。

2、核查意见

经核查，本所律师认为：

（1）报告期各期，发行人与 AMD 的收入与海关数据差异原因合理，其余发行人境外收入与海关数据匹配性较强。发行人境外收入的回款率接近 100%，境外收入与销售回款的匹配性较强；

（2）报告期内，发行人客户集中度较高具有商业合理性；AMD 作为主要客

户，与发行人未来合作具有稳定性，不存在发行人单方面依赖重大客户的情形；

(3) 报告期内，境外收入主要来源国的贸易政策及出口管制等情况未对发行人的境外经营、外销收入产生重大不利影响。

二、报告期内境外前五大供应商基本情况及采购情况；是否存在依赖进口、相关原材料是否存在国产替代、贸易摩擦及国际关系形势等对公司境外采购的具体影响。

报告期各期，发行人境外采购分别为 994,727.64 万元、1,044,571.80 万元和 981,641.05 万元，占当期采购总额的 49.26%、49.46% 和 37.40%。

(一) 报告期内境外前五大供应商基本情况及采购情况

报告期各期，发行人向境外前五大供应商的采购金额分别为 732,164.71 万元、637,583.36 万元和 730,305.25 万元，占当期采购总额的 36.26%、30.19% 和 27.82%。

报告期各期，若合并计算来自向境外供应商及其境内控制主体的采购金额，发行人向境外前五大供应商采购情况如下：

供应商名称	主要采购内容	供应商所在国家或地区	采购金额（万元）		
			2025 年度	2024 年度	2023 年度
供应商 A	基板	中国台湾	137,072.07	88,243.77	191,709.70
供应商 B	基板	日本	142,252.46	138,240.31	190,410.03
供应商 D	基板	中国台湾	129,658.13	168,970.40	133,553.46
供应商 E	基板	韩国	115,069.99	95,694.94	80,183.06
供应商 F	基板	日本	94,747.79	73,986.11	118,800.96
供应商 G	基板	奥地利	111,504.81	72,447.83	17,507.50
合计			730,305.25	637,583.36	732,164.71
占总采购额的比例			27.82%	30.19%	36.26%

(二) 是否存在依赖进口、相关原材料是否存在国产替代

报告期内，发行人的主要原材料包括基板、框架、键合丝、塑封料、装片胶等，主要来自供应商 A、供应商 B、供应商 D 等境外封测材料生产企业。此类

境外封测材料供应商的起步时间较早，技术和产品相对成熟，企业规模较大。相对而言，国内厂商进入该行业时间较短，与境外的知名供应商相比存在一定差距。同时，发行人作为全球领先的半导体封测行业公司，所服务的境外知名客户亦对其供应链中间接供应商的选择有一定的要求。

随着国内集成电路产业的快速发展，在市场需求拉动和国产化浪潮的推动下，国内涌现出了较多专注于封测材料研发、生产的企业，总体能够满足发行人对封测材料的基本需求。近年来，发行人一直坚持推进对国内原材料供应商的拓展，致力于建立更加完备、便捷、更有韧性的原材料供应链体系。发行人所需的主要原材料在境内均有可提供同类原材料的供应商。

现阶段，发行人生产所需的各主要原材料的境外供应商及其国产替代供应商情况如下：

原材料	报告期内同类原材料境外采购的占比	目前主要境外供应商	提供同类原材料且已发生采购的境内供应商
基板	77.43%	供应商A、供应商B、供应商D、HAESUNG DS Co. Ltd.、Simmtech International Pte.Ltd.、Daeduck Electronics Co.,Ltd.、Kyocera	广州广芯封装基板有限公司、广州兴森快捷电路科技有限公司
框架	72.41%	AAMI Pacific HongKong Limit.、供应商F、Mitsui High-tec, Inc.、HAESUNG DS Co. Ltd	崇辉半导体（江门）有限公司、新恒汇电子股份有限公司、宁波康强电子股份有限公司、苏州兴胜科半导体材料有限公司
键合丝	1.21%	Ametek Engineered Materials Sdn.、TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES.、REEHONG TECHNOLOGY (HK) CO.、光大应用材料科技股份有限公司、乐金股份有限公司	常州市润祥电子科技有限公司、田中电子（杭州）有限公司、铭凯益电子（昆山）股份有限公司
塑封料	78.74%	苏州住友电木有限公司、XP Electron International Co.,Ltd.、力森诺科材料（上海）有限公司、KCC Corporation、上海京瓷商贸有限公司	江苏华海诚科新材料股份有限公司、江苏中科科化新材料股份有限公司、长春封塑料（常熟）有限公司
装片胶	12.12%	FUJIFILM ELECTRONIC.、ABLESTIK 上海.、ALPHA ADVANCED MATERIAL.、力森诺科材料（上海）有限公司、苏州	东莞德邦翌骅材料有限公司

原材料	报告期内同类原材料境外采购的占比	目前主要境外供应商	提供同类原材料且已发生采购的境内供应商
		住友电木有限公司	

综上所述,由于境外封测材料供应商的起步时间较早,技术和产品相对成熟,企业规模较大,发行人目前的关键原材料、设备主要来自进口;但发行人亦与国产封测材料、设备生产厂商建立了商业联系,并开始从境内供应商采购来逐步实现国产化替代目标。报告期内,发行人作为国内领先的封装企业,部分原材料因行业技术特性等因素,存在境外采购较多的情况,但该等采购符合半导体封装测试行业上游的市场格局,且未对境外供应商形成实质依赖。

(三) 贸易摩擦及国际关系形势等对公司境外采购的具体影响

报告期内,发行人境外采购主要地区的金额及占比如下:

单位: 万美元

区域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国台湾	29,521.46	21.02%	32,952.27	23.03%	40,600.70	28.97%
日本	24,544.43	17.47%	29,474.23	20.60%	23,836.57	17.01%
美国	12,073.20	8.59%	11,327.58	7.92%	25,728.44	18.36%
马来西亚	10,642.73	7.58%	12,920.75	9.03%	9,532.81	6.80%
韩国	12,112.90	8.62%	11,933.32	8.34%	4,509.75	3.22%
新加坡	10,771.73	7.67%	8,502.33	5.94%	7,476.18	5.33%
奥地利	15,367.81	10.94%	10,186.32	7.12%	2,484.31	1.77%
中国香港	6,095.12	4.34%	3,104.35	2.17%	8,811.18	6.29%
其他	19,347.88	13.77%	22,702.62	15.86%	17,165.97	12.25%
境外采购合计	140,477.26	100.00%	143,103.79	100.00%	140,145.91	100.00%

注: 上表依据进口报关数据计算。

报告期内,发行人的境外采购包括向中国台湾、日本、美国等国家和地区的原材料和设备采购,其中中国台湾、日本等主要采购来源地与中国境内之间的贸易关系相对较为稳定,但以美国为代表的部分国家对我国技术和高端产品的管制日益加剧,针对半导体设备、材料、技术等领域颁布了一系列出口管制政策。报

告期内，美国出台的半导体行业出口管制措施梳理如下：

时间	管制措施
2022年10月	美国商务部修订《出口管制条例》，从高性能芯片（如 A100）供应、半导体制造设备出口等方面，全方位限制我国人工智能及高性能计算产业发展。
2023年10月	美国商务部出台《先进计算芯片规则》和《半导体制造设备出口管制规则》，强化了受控先进计算芯片的参数，并收紧了对半导体制造设备和运往中国大陆以外目的地的物品的管控。
2024年12月	美国商务部修订《出口管制条例》，将出口管制范围进一步扩大到 EDA 软件、更多类型半导体制造设备等高算力芯片的配套产业，并采取多项提高管控效率的措施，包括针对合规性和转运问题的新的警告指引。
2025年1月	美国商务部强化对先进节点集成电路（如 14nm 及以下逻辑芯片、128 层以上 NAND）的制造与封装环节的管控，要求相关企业在涉及受控物项时执行更严格的许可申请与合规审查。
2025年5月	美国商务部宣布强化海外人工智能芯片出口管制，明确限制美国芯片用于训练中国 AI 模型，并提示使用中国国产先进计算芯片（如昇腾系列）可能面临违反出口管制的执法风险。

当前境外针对半导体领域的采购与出口限制性法规，主要以美国商务部工业与安全局发布的《出口管制条例》为主，上述境外管制规则主要涉及 16nm/14nm 及以下先进制程晶圆制造设备、高端算力芯片、先进存储相关物项及核心研发技术，管控重点集中于前端先进制造领域。针对常规封装测试环节所需的通用封装设备、框架基板、塑封料、键合丝等常规原材料，相关管制规则并未纳入核心限制范畴，未对发行人的跨境正常采购设置实质性障碍。

报告期内，发行人在境外原材料采购过程中未发生出口国针对封测原材料出口进行贸易管制的情况，不存在对发行人生产经营产生重大不利影响的情形。未来，如果发行人的主要原材料发生供应短缺，或者供应商所处的国家和地区与中国发生贸易摩擦或外交冲突进而影响到相应原材料的出口，可能会对发行人生产经营及持续发展产生不利影响。发行人已经在本次发行的募集说明书中披露了“主要原材料、设备供应风险”，具体如下：

“报告期各期，发行人境外采购分别为 994,727.64 万元、1,044,571.80 万元和 981,641.05 万元，占各期采购总额的 49.26%、49.46%和 37.40%。”

发行人产品生产所需主要原材料为引线框架、基板、键合丝和塑封料等，且存在向境外厂商采购的情况。未来，如果原材料市场供求关系发生变化，造成原

材料价格上涨，或者因供货商供货不足、原材料质量问题等不可测因素影响发行人产品的正常生产，对发行人业绩产生一定影响。

集成电路封装测试行业对设备有较高要求，部分重要核心设备在国内的合格供应商数量较少，需要依靠进口。未来，如果发行人的重要核心设备发生供应短缺，或者供应商所处的国家和地区与中国发生贸易摩擦或外交冲突进而影响到相应设备的出口，可能会对发行人生产经营及持续发展产生不利影响。同时，发行人本次募集资金投资项目所需的设备部分需要进口，如果设备供应商所在国家的贸易政策发生变化，发行人所需设备无法正常采购，将会影响发行人募集资金投资项目的实施进度，进而对募投项目的投资收益产生不利影响。

发行人持续与国内及国际知名原材料供应商开展合作，关注对应国产设备的发展进展，并在技术可行范围内推进国产设备的验证工作，做好潜在替代方案的技术与工艺储备。”

（四）核查程序和核查意见

1、核查程序

本所律师主要履行了如下核查程序：

（1）查阅发行人主要境外供应商的公开资料，与发行人确认与上述供应商的合作时间；

（2）查阅发行人境外采购的具体内容及金额，查询主要境外供应商的公开资料；

（3）向发行人了解其各类原材料的主要境外供应商情况，并获取其可供替代的境内供应商名单；

（4）查阅境外主要主体关于半导体封测原材料、设备等进出口管制的有关规定，与发行人了解相关规定的具体影响。

2、核查意见

经核查，本所律师认为：

(1) 报告期内，发行人作为国内领先的封装企业，部分原材料因行业技术特性等因素，存在境外采购较多的情况，但该等采购符合半导体封装测试行业发展规律，且未对境外供应商形成实质依赖；

(2) 报告期内，发行人的主要原材料包括基板、框架、键合丝、塑封料、装片胶等，发行人在境外原材料采购过程中未发生出口国针对封测原材料出口进行贸易管制的情况，不存在对发行人生产经营的重大不利影响的情形。

问题 2:

发行人2020年非公开发行股票募集资金为32.72亿元，用于“车载品智能封装测试中心建设”“集成电路封装测试二期工程”“高性能中央处理器等集成电路封装测试项目”和补充流动资金及偿还银行贷款，募投项目效益实现均不及预期。

发行人最近一次再融资为2022年2月核准的非公开发行股票，募集资金26.78亿元，用于“高性能计算产品封装测试产业化项目”“5G等新一代通信用产品封装测试项目”“功率器件封装测试扩产项目”和补充流动资金及偿还银行贷款，并将“5G等新一代通信用产品封装测试项目”“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为公司控股子公司通富通科（南通）微电子有限公司，募投项目均在建设期，尚未完工。

本次发行募集资金总额不超过44亿元，用于投资“存储芯片封测产能提升项目”“汽车等新兴应用领域封测产能提升项目”“晶圆级封测产能提升项目”“高性能计算及通信领域封测产能提升项目”及补充流动资金；各个募投项目的预测毛利率与公司最近一期对应大类产品实际毛利率存在差异；部分募投项目的实施主体为发行人控股子公司，少数股东尚未确定募集资金投入实施主体方式。

报告期各期末，发行人货币资金主要由银行存款构成，金额分别为424206.31

万元、446779.36万元、423165.01万元和564067.15万元。

请发行人补充说明：（1）前次募投项目发生变更的具体原因及其合理性；结合前次募集资金用途变更前后的实际情况，说明非资本性支出占比情况，并核查前次募集资金实际用于补充流动资金的比例是否符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定。（2）请结合前次募投项目的最新实施进度、订单获取情况及收益实现情况，说明部分前次募投项目效益未达预期的具体原因，相关项目实施环境是否发生重大不利变化，以及上述因素是否对本次募投项目的实施产生实质性影响。（3）请说明本次募投项目与公司现有业务及产品、前次募投项目之间的区别与联系，是否存在重复建设情形；进一步说明本次募投项目实施后对公司主营业务及产品结构可能产生的具体影响，以及在前次募投项目尚未全部完工的情况下推进本次募投项目的合理性及必要性。（4）请结合公司目前主要产品的销售情况及产能利用率、主要竞争对手的产能规模及扩产计划、意向客户或已获取订单情况，说明本次新增产能安排的合理性，并说明公司拟采取的具体产能消化措施。（5）请结合行业周期性特征、下游需求变化趋势及同行业可比公司经营情况，说明募投项目效益测算中对项目建设期内行业景气度的假设是否审慎、合理；同时结合行业技术迭代周期、主要竞争对手技术路线及公司相关技术储备情况，说明募投项目全部达产后相关产品及技术是否可能存在无法满足市场需求或被替代的风险。（6）募投项目拟购置主要设备的类型、来源地及主要供应商情况，是否涉及关键设备依赖境外采购的情形；相关设备采购是否受到出口管制、贸易限制或其他贸易政策变化的影响，是否对募投项目建设产生不利影响。（7）请说明募投项目实施后是否可能新增同业竞争或关联交易；同时说明公司通过非全资子公司实施相关项目的原因、必要性及合理性，少数股东是否同比例增资或提供借款，相关安排是否存在损害上市公司及中小股东利益的情形。（8）结合发行人货币资金、交易性金融资产、资产负债率、营运资金需求、带息债务规模及还款安排、银行授信额度及使用情况等，量化测算并说明本次融资必要性和补充流动

资金规模的合理性。

请发行人补充披露（2）（5）（6）涉及的相关风险。

请保荐人和会计师核查并发表明确意见，请发行人律师核查（1）（6）（7）并发表明确意见。

一、前次募投项目发生变更的具体原因及其合理性；结合前次募集资金用途变更前后的实际情况，说明非资本性支出占比情况，并核查前次募集资金实际用于补充流动资金的比例是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

（一）前次募投项目发生变更的具体原因及其合理性

1、前次募投项目变更情况

公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在变更事项；公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况如下：

2023 年 1 月 3 日，公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议，2023 年 1 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，同意公司将“5G 等新一代通信用产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为公司控股子公司通富通科，共涉及募集资金人民币 141,650.00 万元。具体变更情况如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更用途的募集资金金额 (万元)	变更金额占前次募集资金净额的比例
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)		
5G 等新一代通信用产品封装测试项目	90,850.00	微控制器（MCU）产品封装测试项目	78,000.00	78,000.00	29.12%
功率器件	50,800.00	功率器件产品封	63,650.00	63,650.00	23.76%

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更用途的募集资金金额 (万元)	变更金额占前次募集资金净额的比例
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)		
封装测试扩产项目		装测试项目			

公司以该部分募集资金向通富通科增资及提供借款，用于本次变更后的募投项目。借款期限自实施借款之日起，至相关募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实际需要，可滚动使用，也可提前偿还，借款利率不超过银行同期贷款利率，借款到期后，可视通富通科实际经营情况，继续借予通富通科滚动使用。

2、前次募投项目变更的原因及合理性

原募投项目主要面向 5G 手机相关芯片的封测需求，涵盖 WiFi、蓝牙、射频等各类芯片。2023 年度，受手机等消费电子终端需求偏弱影响，原募投项目对应的下游应用领域受到较大程度冲击。相较而言，MCU 芯片对应的下游应用场景更为广泛，可应用于工业控制、智能家居、通信终端、车联网等多个领域，单一终端市场波动对其整体需求的影响相对较小，因而具备更强的抗风险能力。与此同时，随着国内产业链自主可控需求提升，MCU 国产化进程持续推进，相关市场仍处于持续发展阶段。

在此背景下，公司结合下游需求变化、产品应用结构及市场发展趋势，将原募投项目中“5G 等新一代通信用产品封装测试项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”，从而适应市场环境的变化，聚焦于市场前景广阔的细分领域，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力。

同时，公司通富微电老厂区的产能布局相对较满，而 2021 年 10 月新设立的子公司通富通科本身定位于工业和汽车行业芯片以及存储芯片封测基地，覆盖多层堆叠封装、功率模块封装等技术，拥有充足的场地空间。公司本次将上述两项募投项目的实施主体由通富微电变更到子公司通富通科实施，主要系考虑到公司各生产主体之间的产能优化配置，更好地发挥规模效应，提升募集资金的使用效

率，符合发行人整体的战略布局和管理方针。

综上，公司前次募投项目变更系基于考虑行业 and 市场需求、业务产品规划的实际情况，为更好地提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，推动公司更好更快的发展，从而为股东创造更多价值，公司前次募投项目变更具有合理性。

3、变更后募投项目的建设情况与实施进度

变更后，截至 2025 年末的投资进展如下：

变更后募投项目	承诺投资金额	截至 2025 年末累计投资金额	投资进度
微控制器（MCU）产品封装测试项目	78,000.00	66,990.48	85.89% ^注
功率器件产品封装测试项目	63,650.00	65,097.72	102.27%

注：截至 2025 年末，剩余未纳入已投资金额的部分主要系设备采购相关的信用证保证金。由于信用证约定了信用期等支付条件，截至 2025 年末尚未支付完毕，因此部分前期用于支付信用证保证金的募集资金尚未完成释放和置换。

4、结合募投项目变更情况、实际建设情况和投资进度，论述本次募投项目的合理性及可行性

前次募投项目的变更、实际建设及投资进度，不影响本次募投项目的合理性及可行性。具体分析如下：

一方面，原募投项目“5G 等新一代通信用产品封装测试项目”主要应用于消费电子领域，以手机终端应用为主，对应封装形式亦相对传统，如 FCLGA、QFN、QFP 等，对应芯片类型主要为周边芯片如 WiFi、蓝牙、射频等，受行业周期波动影响较大。本次募投项目与上述变更前的募投项目不重叠，其中“高性能计算及通信领域封测产能提升项目”的应用领域虽亦包含手机领域，但主要系针对技术含量较高的主控 SoC、射频模块等，对应 FC、SiP 等先进封测工艺，市场景气度良好，国产替代趋势显著。此外，本次募投项目亦与前次非公开变更后的募投项目不重叠。

另一方面，前次募投项目涉及实施主体和场地的变更，由通富微电老厂区变

更至通富通科新厂区。本次募投项目充分考虑实施主体的定位以及场地的充足性，其中投资金额较大的“存储芯片封测产能提升项目”、“汽车等新兴应用领域封测产能提升项目”由通富通科主体实施，“晶圆级封测产能提升项目”由通富微电主体实施，“高性能计算及通信领域封测产能提升项目”由南通通富主体实施，规划时已考虑公司各生产主体之间的产能优化配置，从而更好地发挥规模效应。

(二) 结合前次募集资金用途变更前后的实际情况，说明非资本性支出占比情况

1、2020 年非公开发行股票

发行人 2020 年非公开发行股票募集资金净额为 324,534.90 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	使用募集资金金额	用于非资本性支出金额
车载品智能封装测试中心建设	103,000.00	-
集成电路封装测试二期工程	76,020.00	-
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	50,000.00	-
补充流动资金及偿还银行贷款	95,514.90	95,514.90
合计	324,534.90	95,514.90

综上所述，发行人 2020 年非公开发行股票募集资金用于非资本性支出的金额为 95,514.90 万元，占募集资金净额的比例为 29.43%。

2、2022 年非公开发行股票

单位：万元

原定投资项目	变更前拟使用募集资金金额	用于非资本性支出金额	变更后实际投资项目	变更后拟使用募集资金金额	用于非资本性支出金额
高性能计算产品封装测试产业化项目	46,000.00	-	高性能计算产品封装测试产业化项目	46,000.00	-
5G 等新一代通信用产品封装测试项目	90,850.00	-	微控制器(MCU)产品封装测试项目	78,000.00	-

原定投资项目	变更前拟使用募集资金金额	用于非资本性支出金额	变更后实际投资项目	变更后拟使用募集资金金额	用于非资本性支出金额
功率器件封装测试扩产项目	50,800.00	-	功率器件产品封装测试项目	63,650.00	-
补充流动资金及偿还银行贷款	80,187.21	80,187.21	补充流动资金及偿还银行贷款	80,187.21	80,187.21
合计	267,837.21	80,187.21	合计	267,837.21	80,187.21

综上所述，发行人 2022 年非公开发行股票募投项目变更前后用于非资本性支出的金额为 80,187.21 万元，占募集资金净额的比例为 29.94%。

（三）前次募集资金实际补充流动资金的比例是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》规定，通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。募集资金用于支付人员工资、货款、预备费、市场推广费、铺底流动资金等非资本性支出的，视为补充流动资金。资本化阶段的研发支出不视为补充流动资金。公司前次募集资金用于非资本性支出的金额均未超出前次募集资金总额的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

（四）核查程序和核查意见

1、核查程序

本所律师主要履行了如下核查程序：

（1）查阅发行人前次募投项目可行性研究报告、发行人关于前次募集资金使用情况的报告；

（2）查阅发行人前次募投项目变更的董事会、股东大会决策文件，访谈发行人了解前次募投项目变更的原因；

(3) 查阅发行人前次募集资金使用台账，了解前次募投项目投资概况和实际投入情况、各项投资构成是否属于资本性支出等情况，复核发行人计算的非资本性支出比例，核查是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

2、核查意见

经核查，本所律师认为：

(1) 发行人前次募投项目发生变更主要是根据国内外半导体封测产业的市场需求变化及优化公司各主体产能配置而进行调整，从而提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，具有合理性；前次募投项目的变更不会对本次募投项目的实施造成实质性影响。

(2) 发行人前次募集资金实际用于非资本性支出比例未超过募集资金总额的百分之三十，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

二、募投项目拟购置主要设备的类型、来源地及主要供应商情况，是否涉及关键设备依赖境外采购的情形；相关设备采购是否受到出口管制、贸易限制或其他贸易政策变化的影响，是否对募投项目建设产生不利影响。

(一) 募投项目拟购置主要设备的类型、来源地及主要供应商情况，是否涉及关键设备依赖境外采购的情形

1、本次募投项目的主要设备类型

本次募投项目主要采购的设备类型如下：

序号	项目	主要采购设备类型
1	存储芯片封测产能提升项目	磨片机、装片机、激光切割机、键合机等
2	汽车等新兴应用领域封测产能提升项目	键合机、装片机、高端测试机、机械手等
3	晶圆级封测产能提升项目	电镀机、自动光学检测机、曝光机、装片机、测试机等
4	高性能计算及通信领域封测产能提升项目	贴片机、印刷机、激光切割机、测试机、自动光学检测机等

2、本次募投项目拟购置设备的来源地和供应商情况

本次募投项目首选设备的主要来源地和供应商情况如下：

单位：万元

项目	国家和地区	采购金额	比例	主要供应商
国产品牌	中国	56,744.62	17.98%	芯源微电子、金海通、北京华峰、长川科技、北方华创等
海外品牌	日本	133,855.46	42.41%	爱德万、DISCO、TOWA、fasfordtechnology
	美国	36,699.55	11.63%	LAM、KulickeandSoffaPte (K&S)、泰瑞达、KLA
	新加坡	36,616.56	11.60%	Besi、ASM、STI
	中国台湾	19,640.97	6.22%	鸿劲精密、GPTC、捷智
	韩国	12,898.32	4.09%	Hanmi、visionsemicon
合计		296,455.48	93.92%	-

（二）相关设备采购是否受到出口管制、贸易限制或其他贸易政策变化的影响，是否对募投项目建设产生不利影响

公司主营业务是集成电路封装和测试，公司本次募投项目建设均采购常规封测设备，不涉及先进晶圆制造领域，本次募投项目拟采购设备当前不存在受到国际贸易限制政策影响的情形。本次募投项目侧重于高端产品的封测产能提升，公司出于设备可靠性和量产良率考虑，设备供应商包含外资厂商，以日本、美国、新加坡等地区的封装设备为主，该情况亦符合半导体封测行业的实际情况。针对所有核心设备，发行人已储备多家来自不同地区的备选供应商，有效分散了供应风险。不存在依赖单一外资厂商的情形。报告期内，发行人采购设备的核心境外供应商均为全球半导体行业内的知名企业，合作年限较长，具备完善的供应链体系和稳定的产能供给能力。此外，发行人已逐步加大国内供应商的培育和合作力度，部分核心设备的国内替代能力持续提升，进一步降低了对境外供应商的依赖程度。

设备名称	境外可提供同类设备的供应商示例	国内可提供同类设备的供应商示例
装片机	Besi、ASM	鑫益邦
键合机	Kulicke and SoffaPte (K&S)、ASM、SHINKAWA	奥特维

设备名称	境外可提供同类设备的供应商示例	国内可提供同类设备的供应商示例
电镀机	LAM、Applied Materials	上海盛美
激光切割机	DISCO、TSK	苏州德龙激光、苏州迈为、苏州海杰兴
磨片机	DISCO、TSK	沈阳和研、苏州迈为、浙江晶盛、华海清科
曝光机	Canon	上海芯上微装、合肥芯碁
机械手	ASM、GTB、HON. PRECISION、Cohu	天津金海通、深科达
测试机	Advantest Corporation、Chroma、Teradyne	北京华峰、长川科技
自动光学检测机	CAMTEK、KLA	格兰达、中科飞测、九纵智能

综上，上述情况对本次募投项目的实施不存在不利影响。

（三）相关风险披露情况

发行人已在募集说明书“重大风险提示”、“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“五、本次募投项目相关风险”中对相关风险予以补充披露，具体补充披露内容如下：

“（四）募投项目进口品牌设备受贸易管制措施限制的风险

本次募投项目侧重于高端封装测试产品产能建设，在规划首选的拟购置设备时，部分关键设备涉及境外品牌，存在一定程度的进口采购需求。本次募投项目主要境外品牌设备所涉及的国家和地区有日本、美国、新加坡、中国台湾、韩国，对应的募投项目设备金额为 23.97 亿元，占本次募投项目拟购置设备总额的比例为 75.95%。虽然公司已与相关设备供应商建立了长期稳定的合作关系，主要供应渠道整体较为成熟，且报告期内相关设备采购总体正常，但若未来国际贸易环境、出口管制政策、关税政策等发生不利变化，导致相关设备无法按期交付、采购成本上升、安装调试延期或售后技术支持受限，则可能对募投项目的设备采购、建设进度、投产节奏及预期效益实现造成不利影响”。

（四）核查程序和核查意见

1、核查程序

本所律师主要履行了如下核查程序：

（1）查阅本次募投项目设备明细表、品牌对应国家、供应商情况等；查阅公开信息，复核封测设备厂商的基本情况；

（2）访谈了解发行人所采购的主要封测业务类别及储备的供应商情况，以及发行人分散供应商风险的主要举措；

（3）查阅同行业可比公司资料，确认封测企业采购较高比例境外品牌设备的合理性；

（4）查阅全球主要区域的出口贸易政策，对封测行业设备的管制情况等。

2、核查意见

经核查，本所律师认为：

本次募投项目侧重于高端产品的封测产能提升，公司出于设备可靠性和量产良率考虑，设备供应商包含外资厂商，以日本、美国、中国台湾等地区的封装设备为主，该情况亦符合半导体封测行业的实际情况。相关设备采购不存在受到出口管制、贸易限制或其他贸易政策变化的影响，对募投项目建设不存在不利影响。

三、请说明募投项目实施后是否可能新增同业竞争或关联交易；同时说明公司通过非全资子公司实施相关项目的原因、必要性及合理性，少数股东是否同比例增资或提供借款，相关安排是否存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（一）请说明募投项目实施后是否可能新增同业竞争或关联交易

本次募投项目包括存储封测、车载封测、晶圆级封测、高性能计算及通信封测，均围绕公司主业开展。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业从事相同、相似业务的情况，本次募集资金投资项目实施后不存在新增同业竞争的情形。本次募投项目实施过程中和实施后公司的业务模式和经营战略保持不变，与关联方之间的业务关系不会因本次发行而发生变化。结合本次募投项目的设备

采购供应商、目标客户、公司主要原材料供应商等情况，预计本次募投项目的实施不存在新增关联交易的情形，如未来实际发生关联交易，公司将根据关联交易的相关制度，履行相应程序或对外披露的义务（如需）。

（二）公司通过非全资子公司实施相关项目的原因、必要性及合理性，少数股东是否同比例增资或提供借款，相关安排是否存在损害上市公司及中小股东利益的情形

截至本回复出具日，通富通科的原少数股东南通崇川信创产业投资基金合伙企业（有限合伙）已与上市公司签署《股权转让协议》，将其所持有的通富通科13.75%少数股权全部转让给通富微电。至此，本次募投项目的实施主体均为发行人全资子公司，不存在通过非全资子公司实施项目的情形，亦不存在据此损害上市公司及中小股东利益的情形。

（三）核查程序和核查意见

1、核查程序

本所律师主要履行了如下核查程序：

（1）查阅本次募投项目涉及的设备供应商、原材料供应商、下游客户情况，获取发行人关联方清单并进行比对；

（2）查阅发行人本次募投项目实施主体的股权结构、《股权转让协议》等相关资料。

2、核查意见

经核查，本所律师认为：

预计本次募投项目实施后不新增同业竞争或关联交易；本次募投项目不存在通过非全资子公司实施项目的情形，亦不存在据此损害上市公司及中小股东利益的情形。

二十三、总体结论

综上所述，本所律师认为：

本所律师认为，补充事项期间，上述变动不存在影响发行人本次发行的重大法律问题，发行人的主体资格合法，本次发行的批准和授权有效，仍具备向特定对象发行股票的实质条件；除尚需取得深交所的审核同意，并报中国证监会履行发行注册程序外，发行人本次发行在形式和实质条件上仍符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定。

本补充法律意见书经经办律师签字并加盖北京大成律师事务所公章后即具有法律效力。

(此页无正文，为北京大成律师事务所《关于通富微电子股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票并上市之补充法律意见书（二）》之签
字页)

北京大成律师事务所（盖章）



负责人或授权代表：

李寿双

经办律师：

王念

陈玲玲

吴凌云

2026年 6 月 1 日

北京大成律师事务所 授权委托书

本人袁华之作为北京大成律师事务所负责人，授权本所李寿双在我所
证券项目法律文件上代理本人签名，特此授权。



北京大成律师事务所

委托人：袁华之

职务：事务所负责人

委托人签字：袁华之

受托人：李寿双

受托人签字：



2026年2月10日